

IMDS资料做成手册

株式会社电装天

品質・技術推進本部 技術管理部 設計管理室 標準管理課

11A-411624-0002

制定 2019年9月4日

修订 2024年11月3日

Ver.1.40

目录

1 . 前言	· · ·	P3
2 . IMDS报告的基本思考方法	· · ·	P6
3 . IMDS的填写方法(基本)	· · ·	P9
4 . IMDS的填写方法(电装天固有)	· · ·	P12
5 . IMDS的警告内容相关	· · ·	P38
6 . 物质调查资料作成上的注意点	· · ·	P48
7 . 使用电装产品编号的 IMDS 报告(补充信息)	· · ·	P66
8 . 咨询窗口	· · ·	P70

1.

前言

(1)目的

(2)适用范围

1. 前言

(1) 目的

本手册总结了使用IMDS来进行的物质调查资料的作成方法、报告方法。

- IMDS资料的基本填写方法，请参考IMDS推荐手册、IMDS用户手册、IMDS练习指导手册。
- 关于电装天固有的要求事项，请确认本手册。

※ IMDS(International Material Data System)

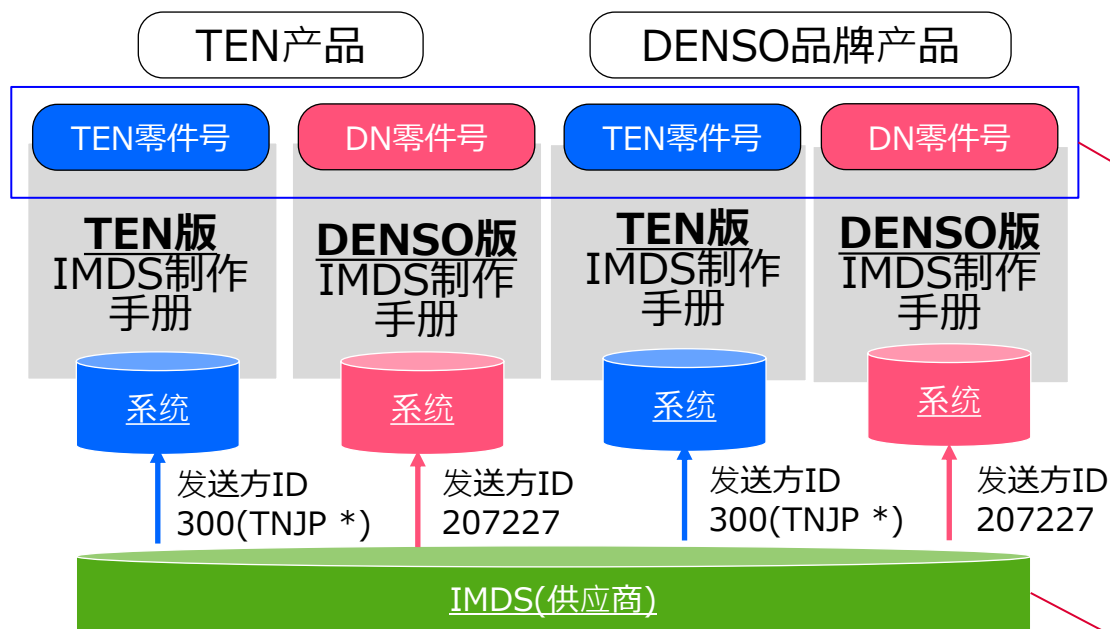
- 以德国汽车工业会（VDA）为中心进行开发。包含日本在内的世界主要汽车厂商都作为会员加入并进行运营的全球性汽车业界标准的基础资料。

- 另外，关于IMDS资料的品质向上活动，也请活用本手册。

(2) 适用范围

- 本手册适用于供应商向电装天 报告的IMDS 数据，该数据由电装天 零件号操作。
电装版本的手册适用于使用电装零件号操作的产品。

[适用范围] 以TEN名义订购的部件



*根据从TEN下单的公司不同，ID也不同。（详情见第18页）

▼ 零件号体系（图纸标记） ▼



▼ IMDS中输入的零件号 ▼



2.

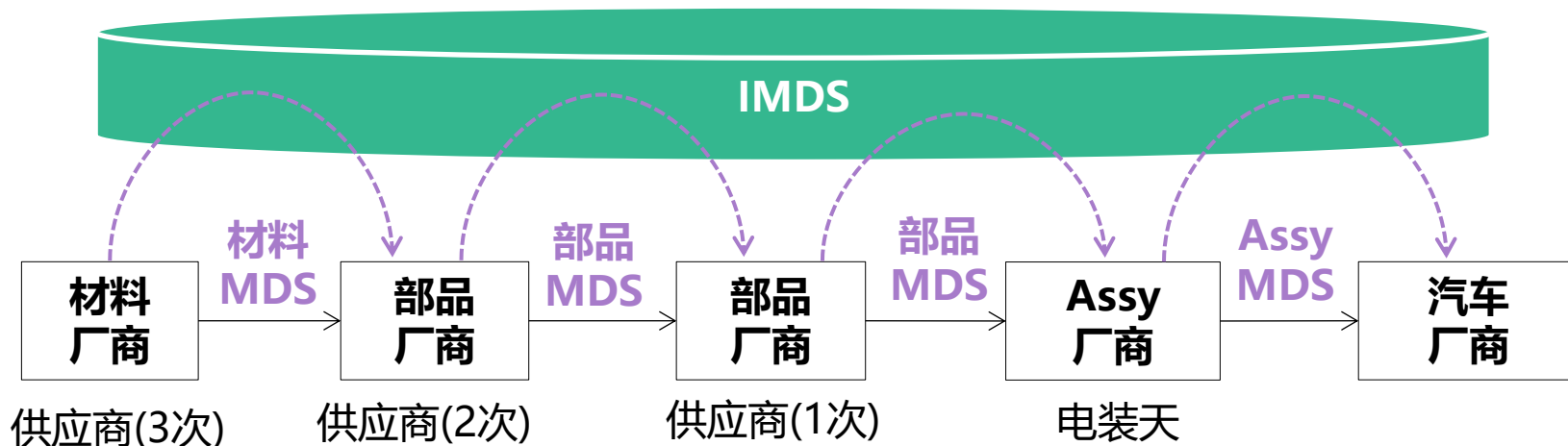
IMDS报告的基本思考方法

- (1)调查、报告方法
- (2)关于机密情报
- (3)关于纳入品中的反应性材料

2. IMDS报告的基本思考方法

(1)调查・报告方法

请各位供应商就购入的部品·材料等内容，按照供应链进行回溯，调查含有物质（成分），并向我司进行报告。



IMDS (International Material Data System)

汽车业界为了对应法律法规从而收集MDS资料用的Web上的基础资料。最终以向汽车厂商提交MDS为目的，作为以供应链来传达MDS情报的手段而被广泛使用中。

MDS (Material Data Sheet)

制品以及部品的构成材料与构成该材料的化合物的相关的资料。

(2)关于机密情报

关于非公开物质(成分)，请控制在均值材料的10%为止。

届时，请注意在「TDC-002 制品含有化学物质管理基准」中进行规制的物质，请不要进行非公开处理。

(3)关于纳入品中的反应性材料

请报告我司最终制品中的含有状态。

特别是热硬化性树脂、粘着剂、涂料、焊锡等需要报告反应后的最终含有（附着）物质。

3.

IMDS的填写方法(基本)

(1)IMDS推荐手册

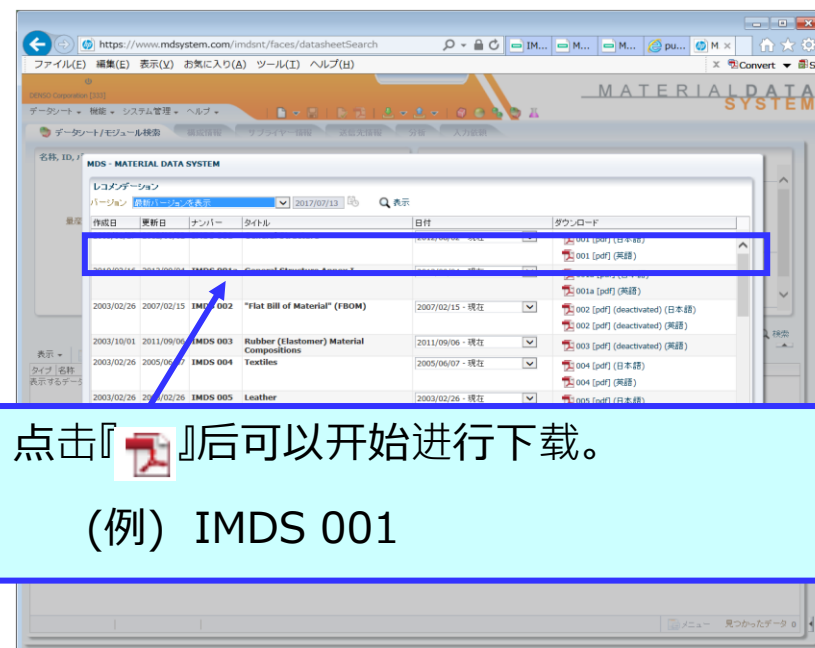
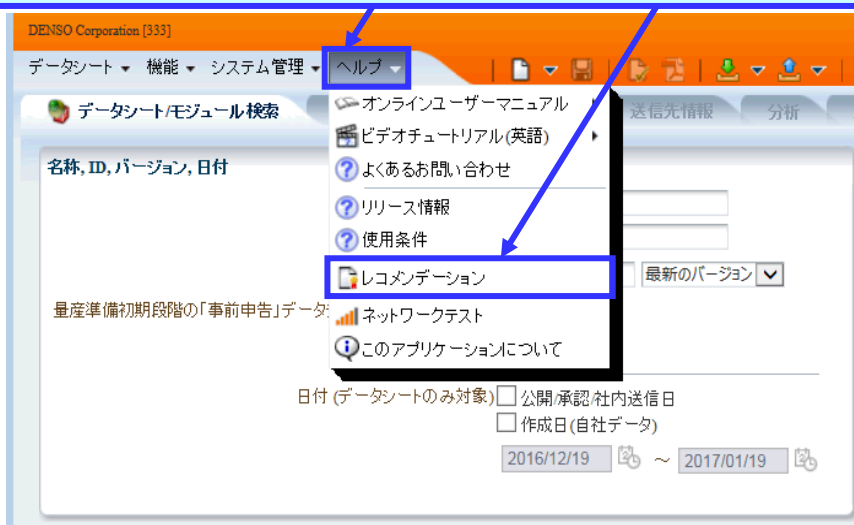
(2)IMDS用户手册・IMDS练习指导手册

3. IMDSの填写方法(基本)

(1) IMDS推荐手册

- ・ IMDS对于填写规则, 提供了IMDS推荐手册作为参考。这也是IMDS指导委员会所推荐的内容。
- ・ 请登录到以下的IMDS画面后进行下载。

登录后, 请点击菜单栏的『帮助』选项下的『建议』进行下载。



点击『📄』后可以开始进行下载。

(例) IMDS 001

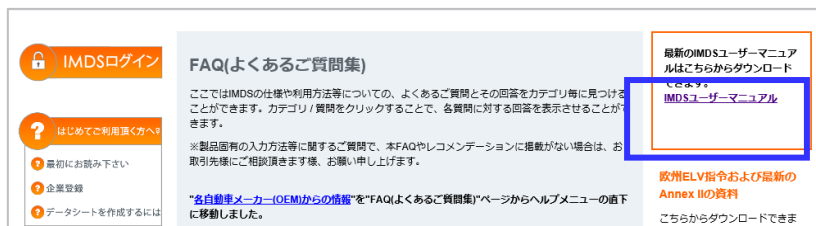
(2) IMDS用户手册・IMDS练习指导手册

・IMDS用户手册・IMDS练习指导手册，请从下述的URL中进行下载。

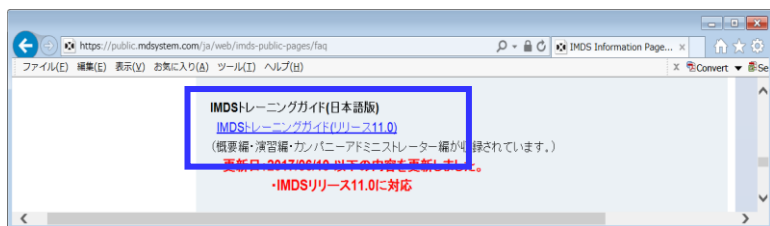
<https://public.mdssystem.com/zh/web/imds-public-pages/faq>



请确认下方内容



请继续向下确认



进去后可以看到FAQ(常见问题)。

蓝色框体中可以看到IMDS用户手册(中文版)

- ・IMDS的操作手册。
包括如何确认有误内容等信息。

蓝色框体中可以看到IMDS练习指导手册(日语版)

- ・IMDS的练习指导手册。
里面详细地记载了操作方法等内容。

※该资料无中文版

4.

IMDS的填写方法(电装天固有)

- (1)基本项目
- (2)材料
- (3)商品材料名
- (4)量产准备阶段的「事先申请」
- (5)APP CODE
- (6)填充材记号
- (7)再利用情报
- (8)提出对象品番
- (9)制品中包含电装天支给部品的情况
- (10)提出方法 (不定形材料)

4. IMDS的填写方法(电装天固有)



(1)基本项目

IMDS画面	项目	填写方法									
构成情报画面	①部品番号 (TOP)	・ 请填写电装天品番 ※15位(注意需要有" -" 标志)									
	②部品名称 (TOP)	・ 请填写电装天品名									
	③品番 (子部品)	・ 当存在电装天品番的情况, 请填写电装天品番。如果没有的话, 可以填写供应商品番或者其他任何品番。									
	④部品名称 (子部品)	・ 当存在电装天品名的情况, 请填写电装天品名。如果没有的话, 可以填写供应商品名或者其他任何品名。									
接收方情报画面	⑤名称	・ 请填写电装天品名									
	⑥部品番号	・ 请填写电装天品番 ※15位(注意需要有" -" 标志)									
	⑦接收方ID/组织ID	・ 300 (向电装天本社报告的情况) 向上述公司以外提交资料的情况请参考【接收方企业ID(组织ID)一览】									
	⑧供应商口座	・ 空栏									
	⑨转发设定	・ 请选择挑勾 (可以转发)									
全画面共通	⑩ID/Version	・ 请确认是以下哪一种之后再报告									
		<table><tr><th>品番</th><th>ID</th><th>Version</th></tr><tr><td>有变更 (包含次要更改)</td><td>新建</td><td>可以是小数或整数</td></tr><tr><td>无更改 (内容修改、再次报告时)</td><td>相同</td><td>新版本 可以是小数或整数</td></tr></table>	品番	ID	Version	有变更 (包含次要更改)	新建	可以是小数或整数	无更改 (内容修改、再次报告时)	相同	新版本 可以是小数或整数
		品番	ID	Version							
有变更 (包含次要更改)	新建	可以是小数或整数									
无更改 (内容修改、再次报告时)	相同	新版本 可以是小数或整数									

< 构成情報画面 >

データシート ▼ 機能 ▼ システム管理 ▼ ヘルプ ▼

データシート/モジュール検索 構成情報 * サプライヤー情報 送信先情報 * 分析 入力依頼

フィルター GADSL 規制情報の表示

PRODUCT

- 1x PART A
 - 10.0g Steel SPCC
- 1x PART B
 - 3.0g Copper Alloy
 - 2.0g Sn96,5Ag3Cu0,5 (Soft solder A30C5)

詳細

共通情報

タイプ コン

ID/バージョン 868838518

ノードID 868838518

ノード数 32

サプライヤー DENSO TEN Limited

部品名称 PRODUCT *

部品番号 123456-78900700

生産準備初期段階の「事前申告」データシート ☐

日付

作成日 2019/

確認/リリース日 なし

数量と質量

部品質量 15 g *

部品質量(自動計算値) 15.0 g

自動計算値との差 0.0% ?

②部品名称 (TOP)
请填写TEN的品名

①部品品番 (TOP)
请填写TEN的品番
※15位(需要有 "-" 存在)

< 构成情报画面 >



④部品名称 (子部品)

存在电装天品名的情况, 请填写电装天的品名。如果没有电装天品名的话, 请填写供应商品名或者任意品名。

③品番 (子部品)

存在电装天品番的情况, 请填写电装天的品番。如果没有电装天品番的话, 请填写供应商品番或者任意品番。

< 接收方情报画面 >

データシート・機能・システム管理・ヘルプ

データシート/モジュール検索 構成情報* サプライヤー情報 送信先情報* 分析 入力依頼

名称 PRODUCT | ID/バージョン 868838518 / 0.01 | ノードID 868838518 | ステータス 編集モード

送信 全送信 社内送信 公開

DENSO TEN Limited [300] 編集モード (2019/10/03)

詳細

送信情報

企業 DENSO TEN Limited [300]

組織 -

送信先ステータス 編集モード

サプライヤーコード

名称 PRODUCT

部品番号 123456-78900700

旧式スペアパーツ ☐

送受信/確認日 なし

転送許可 ☒

図面情報

図面番号

図面作成日

設計変更番号

発注書

発注番号

レポート

レポート日

⑦ 接收方企业ID/组织ID
请设定与贵司交易的公司的企业ID (组织ID)
(向电装天本社直接报告的情况请填写300)

⑧ 供应商口座号
空栏

⑤ 名称
填写电装天的品名

⑥ 部品番号
填写电装天的品番
※15位(包括“-”在内)

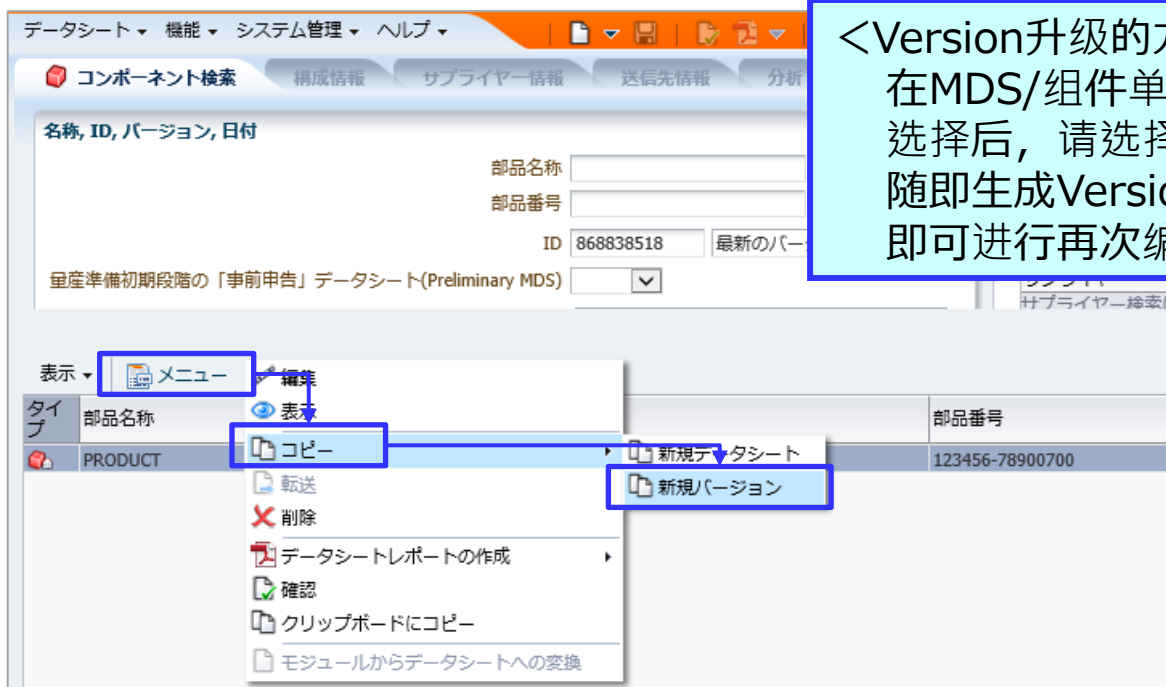
⑨ 转发设定
请选择挑勾(可以转发)

<全画面共通>



⑩ID/Version

- ・产品编号有变更(包含次要更改)：请用新ID报告
- ・无产品编号更改(内容修改、再次报告时)：请报告相同的ID/新版本
- ・版本可以是小数或整数



<Version升级的方法>

在MDS/组件单元查找中搜索对象资料、选择后，请选择「主菜单」→「复制」→「新版本」。随即生成Version升级后的资料表单，即可进行再次编辑。

< 接收方企业ID(组织ID)一览 >

- 请设定与贵司直接进行交易的公司的企业ID(组织ID)，并进行资料的发送。

公司名	会社名(略称)	企业ID	组织ID
DENSO TEN Limited	TNJP	300	-
DENSO TEN AMERICA Limited	TNAM	-	58351
DENSO TEN ESPAÑA, S.A.	TNES	-	100225
DENSO TEN (THAILAND) Limited	TNTH	-	133074
电装天国际贸易（天津）有限公司 (DENSO TEN TRADING (TIANJIN) Limited)	TNTT	-	71506
电装天电子（无锡）有限公司 (DENSO TEN ELECTRONICS (WUXI) Limited)	TNWX	-	59556
DENSO TEN PHILIPPINES CORPORATION	TNPH	-	209754
DENSO TEN MINDA INDIA Private Limited	TNMI	-	209755

(2)材料

- IMDS中，官方规格中含有IMDS Committee 材料的情况，需要使用IMDS Committee 材料的专用规则。
- 当使用该材料的时候，不可以独自作成资料清单，而是需要使用由IMDS指导委员会公开的材料清单。（IMDS 推荐手册 4.4.1.1 ）

※ IMDS Committee 材料是什么

- IMDS的标准材料（IMDS由IMDS指导委员会公开的材料清单）的统称。
- 在IMDS中，EU（EN·DIN规格等）、日本（JIS规格）、美国（ASTM规格·UNS规格）、ISO规格等的官方规格材料作为IMDS Committee 材料 进行登录，IMDS Committee 材料可以免除IMDS的错误确认手续。

< IMDS Committee 材料的填写方法 >

①材料情报的确认

- 根据仕様书、图纸、JIS规格等的情报，来确认JIS规格番号、材料记号。

< 例 > 以不锈钢棒为例。

JIS规格番号: JISG4303

材料记号: SUS316N

JIS规格番号、材料记号等 可以在 JIS的官方主页等进行确认。

JIS规格的官方主页 : <http://www.jisc.go.jp/>

另外，以下JAMA表外部清单精选中的、「MAT」表单也可以进行参考。

表面处理 識別	構成材料名称(英語)	構成材料名称(日本語)	材料規格	材料コード (金属・その他)	材料記号 (樹脂・ゴム)	VDA材料分 類 コード	IMDS登録名 称
	Stainless Steel SUS316N	ステンレス鋼棒	JISG4303	SUS316N		1.1.2	SUS316N

Cover CA MAT UNIT2 IMDS_PCTYPE IMDS_NORM IMDS_CATEGORY (+)

MAT 表单

JIS规格番号: JISG4303

材料记号: SUS316N

②IMDS的登录状况确认

- 在IMDS的材料检索画面中填写 JIS规格番号：JISG4303、材料记号：SUS316N。
- 在IMDS中，材料需要设定模块ID以及版本号码进行管理。
官方规格的更新、误填写修正等，需要使用新规版本的信息进行再次登录。

(1)请单击材料检索标志 () 。

(2)标准材料CODE请填写
『SUS316N』。

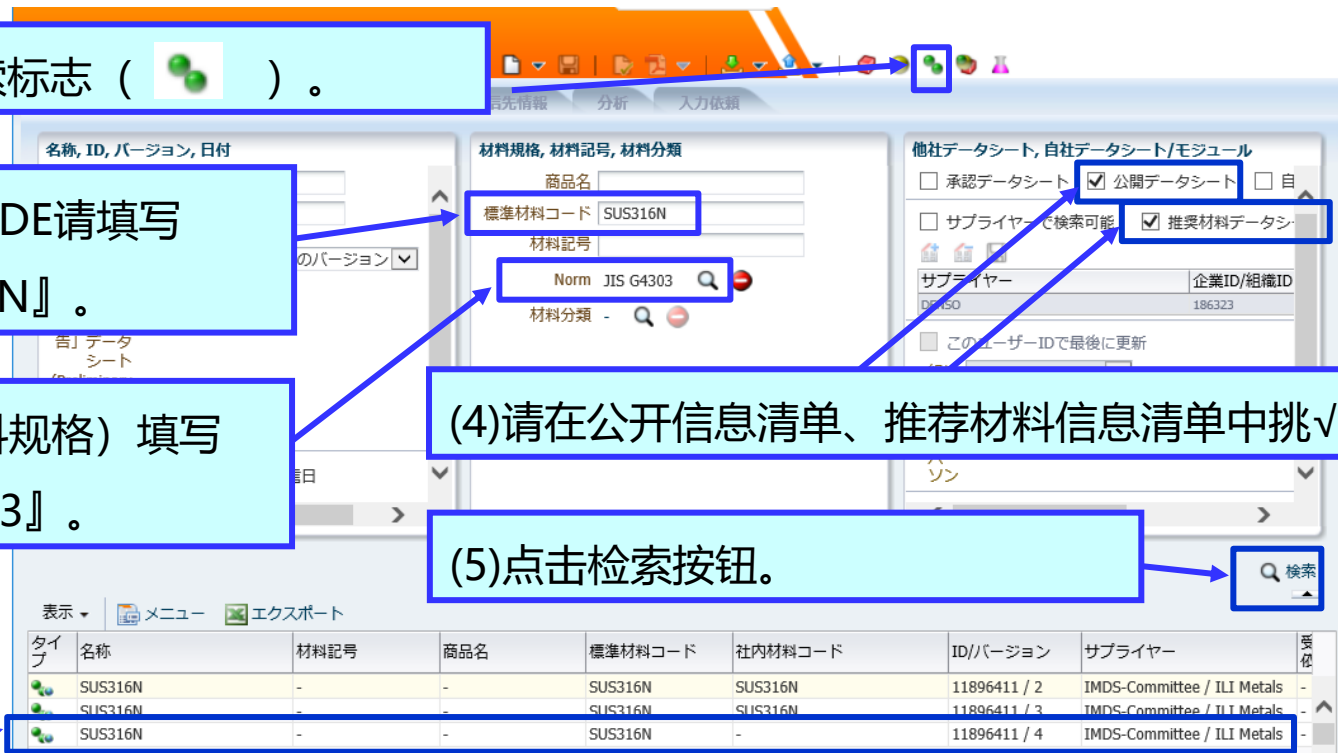
(3)Norm (材料规格) 填写
『JISG4303』。

(4)请在公开信息清单、推荐材料信息清单中挑✓。

(5)点击检索按钮。

(6)符合选项的IMDS Committee 材料会显示在下方。(单击后将显示详细情报→次页)

- 关于同样的SUS316N，由于版本不同，所以登陆的IMDS Committee 材料有若干个。
- 作为电装天而言，请使用最新版本号的信息进行报告。(此事例中为：11896411/4)



The screenshot shows the IMDS material search interface. Annotations point to various fields and buttons:

- (1) Points to the material search icon in the top right.
- (2) Points to the '標準材料コード' (Standard Material Code) field, which contains 'SUS316N'.
- (3) Points to the 'Norm' (Material Specification) field, which contains 'JIS G4303'.
- (4) Points to the '公開データシート' (Public Data Sheet) and '推奨材料データシート' (Recommended Material Data Sheet) checkboxes, both of which are checked.
- (5) Points to the '検索' (Search) button.

The search results table is displayed at the bottom:

タイプ	名称	材料記号	商品名	標準材料コード	社内材料コード	ID/バージョン	サプライヤー	選定
	SUS316N	-	-	SUS316N	SUS316N	11896411 / 2	IMDS-Committee / ILI Metals	-
	SUS316N	-	-	SUS316N	SUS316N	11896411 / 3	IMDS-Committee / ILI Metals	-
	SUS316N	-	-	SUS316N	-	11896411 / 4	IMDS-Committee / ILI Metals	-

③IMDS的登录内容确认

材料『SUS316LN』の登录内容显示在下方。

化合物成分已展示在此

标准材料CODE中，材料记号：SUS316N 已被显示

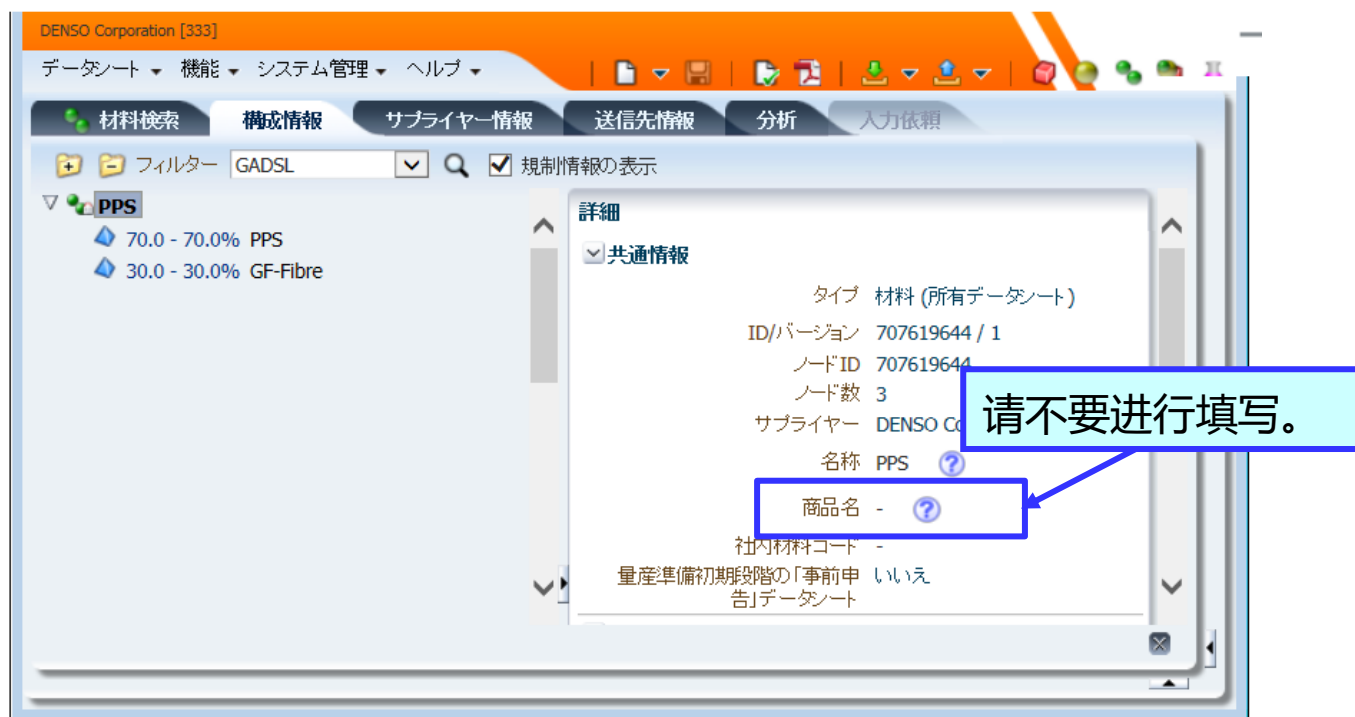
官方材料规格栏中、JIS规格番号：JISG4303 已经显示
※JIS规格有3种，但是在IMDS Committee 材料中，只登录其中一个。

The screenshot displays the IMDS interface for DENSO Corporation. The sidebar on the left shows the chemical composition of SUS316LN, with Nickel highlighted. The main area displays material information, including the ID/Version (11896411 / 4), Node ID (74819757), and Supplier (IMDS-Committee / ILI Metals). The material name is SUS316N. The standard material code is SUS316N. The material classification is 1.1.2 highly alloyed. The table of public material specifications shows JISG4303 as the registered specification.

企業	材料規格	材料規格コード
-	JIS	G4303
-	JIS	G4304
-	JIS	G4305

(3)材料商品名

- ・ 向电装天报告时，商品名栏，请不要进行填写。
- ・ 因为从各位供应商处接收的资料，电装天是无法进行修改的，所以各位供应商的制品、材料等涉及到机密情报的部分，需要各位供应商自己进行斟酌。



※各位材料厂商准备的材料等，无法进行修改的情况，请另行进行联络。

(4)量产准备阶段的「事前申告」

- ・ 我司需要贵司提交量产部品的资料信息。
- ・ 在我司没有依赖的前提下，请不要提交量产准备阶段的「事前申告」资料清单表。

< 注意 >

- ・ 从海外的2次供应商拿到的资料中，可能已经有包含该确认信息的资料数据。如包含有类似资料，可能会从我司的客户处要求重新提交。如果发生该情况，就算资料内容完全一致也是需要再次提交，再次调查的，请务必注意。

The screenshot shows a software window titled 'データシート/モジュール検索' (Data Sheet/Module Search). The left sidebar shows a tree structure with 'DENSO ASSY' selected. The main area displays details for 'DENSO ASSY' with the following information:

- タイプ: コンポーネント (所有データシート)
- ID/バージョン: 707601957 / 0.01
- 部品番号: 1234561000
- 量産準備初期段階の「事前申告」データシート: ☐ (This checkbox is highlighted by a blue callout box with the text: 如果我司没有依赖，请不要点击该选项。)
- 日付: 作成日 2017/12/13
- 確認/リリース日: なし
- 数量と質量: 部品質量 10.0 g, 部品質量(自動計算値) 10.0 g

(5) APPLICATION CODE

重要的

< 填写方法 >

- APPLICATION CODE, 请根据制品用途来填写CODE内容。

※比如, 铅作为不纯物记载为0.1%以下的情况、请使用APPLICATION CODE 44 来进行报告。

另, 44~47以外的CODE的情况, 都需要有意图性的进行选择, 所以请避免在最小值处填写0。关于这些内容, 如果从客户处得到依赖的话, 请允许我司依赖贵司进行修正。

- 向我司报告时, **请务必注意不要使用次页所列出的APPLICATION CODE。**

※当出现商品的适用除外项目的变更 (APPLICATION CODE的细分化)、APPLICATION CODE的无效化 (13,16,58等) 等情况, 有可能会依赖贵司更新已经报告完成的资料信息。

< 不可使用的APPLICATION CODE >

化合物	APPLICATION CODE (ID)	APPLICATION CODE的定义: APPLICATION(中文参考翻译)	EU ELV指令
铅以及 铅化合物	1	用于机械加工目的的网状物或者亚铅电镀网的合金成分	1(a)、1(b)
	2	机械加工目的的铝合金成分	2(a),(b),(c)(i) 2(c)(ii)
	13	电子回路基板用以及其他电气部品用的熔接 ※IMDS中禁止新规使用	(旧) 8
	16	包含铅的玻璃以及陶瓷母材料的电气部品。 ※IMDS中禁止新规使用 但是, 灯泡的玻璃以及火花塞中的玻璃研磨剂除外。	(旧) 10
	58	顺应针・连接系统中的铅 ※IMDS中禁止新规使用	(旧) 8(f)
	20	其他的用途 (有可能禁止使用)	-
六价铬 化合物	21	防止食用涂层	13(a)
	22	马达大篷车的吸收冷藏库	14.
	20	其他的用途 (有可能禁止使用)	-
	49	支架用的螺栓以及螺母上的防腐蚀涂层	13(b)
镉以及 镉化合物	29	电动车用电池	16
	28	压膜用糨糊	-
	50	驾驶员辅助系统用玻璃制光学部品	-
	20	其他的用途 (有可能禁止使用)	-
水銀および 水銀化合物	25	放电灯管以及仪器面板的照明	15(a),15(b)
	20	其他的用途 (有可能禁止使用)	-
镍	32	可能日常接触的部件表面 (例如把手和带扣) 镍释放率 > 0.5μg/cm2/周	-
多环芳烃物质群	40	不适用	-

< 可根据目的使用的应用程序代码 >

化合物	APPLICATION CODE (ID)	APPLICATION CODE的定义: APPLICATION(中文参考翻译)	EU ELV指令
铅以及铅化合物	53	用于将电气/电子零件连接到电子板上的焊料中的铅、铝电解电容器以外零件的端子和引脚中的铅以及电子板表面处理中的铅	8(a)
	54	用于电气应用的焊料中的铅, 但用于电子基板和玻璃上的焊料除外	8(b)

- 以上为限时使用的申请代码, 请务必确认无误后再提交。我们可能会联系您。
- 我们可能会进行上述以外的咨询。

< 最新のAPPLICATION CODEの確認方法 >

请打开IMDS的FAQ（常见问题）。（下面所述工具没有中文版）

<https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/faq>



请确认问题中的『APPLICATION CODE是否有日文翻译』的内容。
并下载『APPLICATION ID选项英日对照表』。

APPLICATION ID选项英日对照表

IMDS リリース10.0 アプリケーションID 選択表 英語-日本語対照表

Ver.10.0 (2017/05/09) by Japan IMDS Committee

※本資料に掲載されている日本語は現在までの最新版です。最終版のご利用の際は必ず最新版をご確認ください。

英語 (APPLICATION CODE)	日本語 (日本語標準番号)
Lead used as is	以下の用途や材料中の鉛
1 - Alloying element in steel for machining purpose or galvanized steel	機械加工を目的とした鋼材中の鉛
2 - Alloying element in aluminum for machining purpose	機械加工を目的としたアルミ合金中の鉛
3 - Alloying element in copper	銅中の鉛
40 - Alloying element in bearing shells and bushes in engines, transmissions and air conditioning compressors	エンジン、トランスミッション、エアコンに使用されるベアリングシェルおよびブッシュ中の鉛
50 - Alloying element in bearing shells and bushes for all other applications (specifically prohibited)	その他の全ての用途で使用されるベアリングシェルおよびブッシュ中の鉛 (厳禁)
Lead and its compounds used as is	以下の用途や材料中の鉛および鉛化合物
6 - Battery	バッテリー
7 - Wheel balance weight	ホイールバランスウェイト
8 - Valve spring	バルブスプリング
9 - Wheel balance weight	ホイールバランスウェイト
10 - Valve spring	バルブスプリング
11 - Valve spring	バルブスプリング
12 - Carbon brushes for electric motors	電気モーターカーボンブラシ
13 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
14 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
15 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
16 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
17 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
18 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
19 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
20 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
21 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
22 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
23 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
24 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
25 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
26 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
27 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
28 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
29 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
30 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
31 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
32 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
33 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
34 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
35 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
36 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
37 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
38 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
39 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
40 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
41 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
42 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
43 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
44 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
45 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
46 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
47 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
48 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
49 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
50 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
51 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
52 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
53 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
54 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
55 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
56 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
57 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
58 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
59 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
60 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
61 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
62 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
63 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
64 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
65 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
66 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
67 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
68 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
69 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
70 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
71 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
72 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
73 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
74 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
75 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
76 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
77 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
78 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
79 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
80 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
81 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
82 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
83 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
84 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
85 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
86 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
87 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
88 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
89 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
90 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
91 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
92 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
93 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
94 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
95 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
96 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
97 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
98 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
99 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛
100 - Lead in solder used in electronic circuit board applications	電子回路基板に使用される鉛

(6)填充材记号

以填充材的化合物情报为基础，作成填充材记号，并填写材料信息。

- 填充材有两个种类的情况，就像-(GF20+TD10)这样，按照成分比率多的顺序在后面添加「+」

后继续填写后面的成分。

- 填充率的数值需要为整数，小数点请进行四舍五入。(例：11.8→12，10.3→10)

ISO1043-2的情报

物质、材料情报		形状	
B	boron	B	beads, balls
C	carbon	C	chips, cuttings
E	clay	D	powder
G	glass	F	fiber
K	calcium carbonate	G	ground
L	cellulose	H	whisker
M	mineral, metal	K	knitted fabric
P	mica	L	layer
		M	mat
		N	non-woven

< 例 1 >

着色用树脂（黑色）中混入13%碳素粉的情况，
碳素(carbon: C) · 粉(powder: D) · 13% → 填写为-CD13

填充率 (%)

13

填充剂记号 (-\$)

-CD13

< 例 2 >

防止热膨胀用树脂中混入28%玻璃纤维的情况，
玻璃(glass: G) · 纤维(fiber: F) · 28% → 填写为-GF28

填充率 (%)

28

填充剂记号 (-\$)

-GF28

(7)再利⽤情報

- ・请务必填写是否使⽤了再利⽤材料。
如果您使⽤再生材料，请填写所有必填项。

NG

循環材料を含む材料のソース

無機または化石ベース材料の割合

100.0 - 100.0 %

材料にリサイクル材が含まれますか？

OK

循環材料を含む材料のソース

無機または化石ベース材料の割合

100.0 - 100.0 %

材料にリサイクル材が含まれますか？

OK

循環材料を含む材料のソース

無機または化石ベース材料の割合

100.0 - 100.0 %

材料にリサイクル材が含まれますか？

一次無機または化石ベース材料の割合

* - * %

リサイクルの割合

* - * %

请务必填写是否使⽤了再利⽤材料。

如果您使⽤再生材料，请填写所有必填项。

<如何查看回收信息是否有回复>

- 您可以使用 IMDS 搜索功能检查回收信息是否已得到答复
请务必检查是否有任何“未答复”并输入“是”或“否”

The screenshot shows the IMDS search interface with the following components:

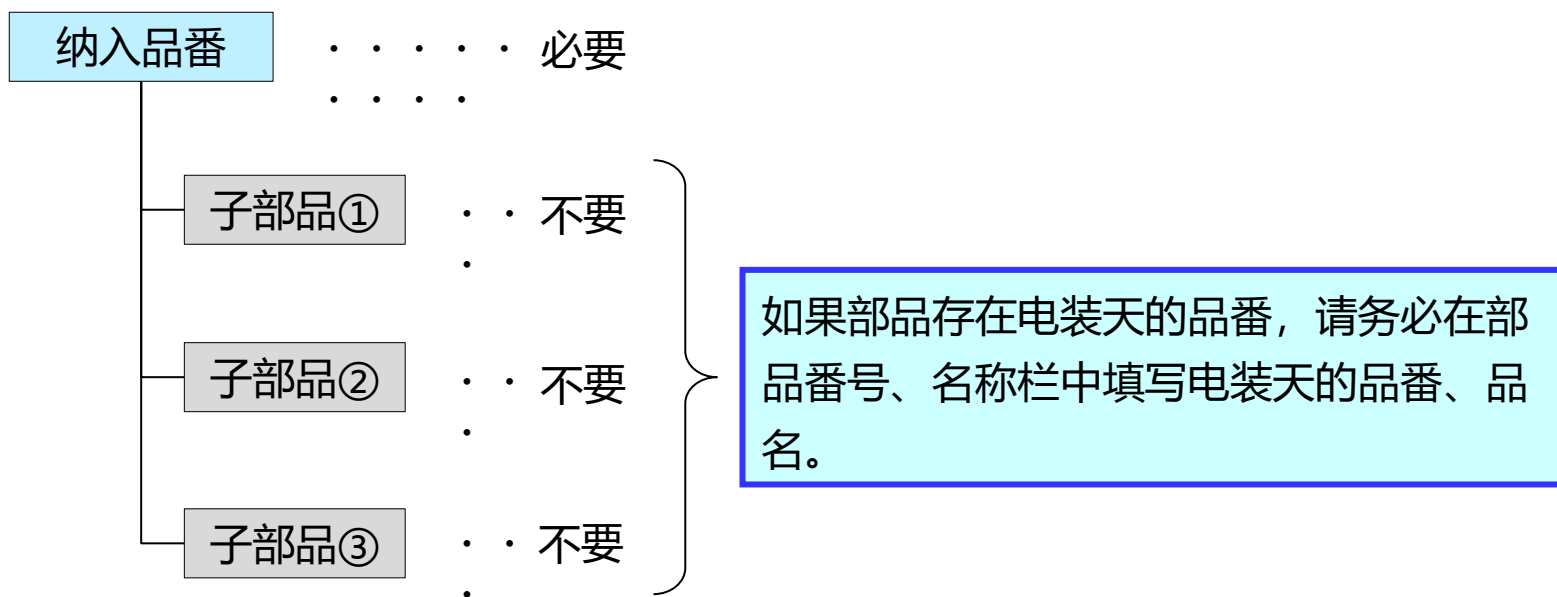
- ① 点击搜索标记**: A magnifying glass icon in the top right corner of the search panel.
- ② タイプ：选择“循環材料を含む材料のソース”**: A dropdown menu labeled "タイプ" (Type) with the selected option "循環材料を含む材料のソース" (Source of material containing recycled material).
- ③ リサイクル含有率：选择“未回答”**: A dropdown menu labeled "リサイクル含有率" (Recycling content rate) with the selected option "未回答" (No answer).
- ④ 点击搜索**: A button labeled "検索" (Search) at the bottom of the search panel.
- ⑤ 可以识别“未回答”的部分**: A blue box highlighting the "未回答" (No answer) option in the "リサイクル含有率" dropdown.
- ⑥ 单击“查找下一个”以查看数据中的所有内容**: A button labeled "次を検索" (Search next) at the bottom right of the search panel.

The search results show a list of materials, including "Steel SPCC". The "リサイクル含有率" (Recycling content rate) column is highlighted in blue, indicating the "未回答" (No answer) status.

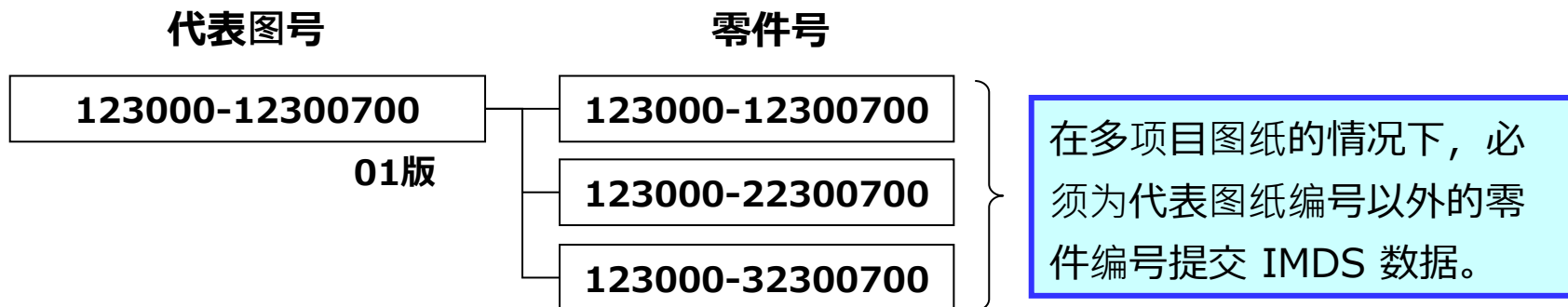
(8)提出对象品番

- 请在IMDS资料中提交我司纳入用的单位品番。

子部品的单位品番不需要提供。但是，如果是存在电装天品番的部品请务必在部品番号、名称栏中填写电装天的品番、品名。



- 在多项目图纸的情况下，必须为代表图纸编号以外的零件编号提交 IMDS 数据。



※图纸上的零件号示例

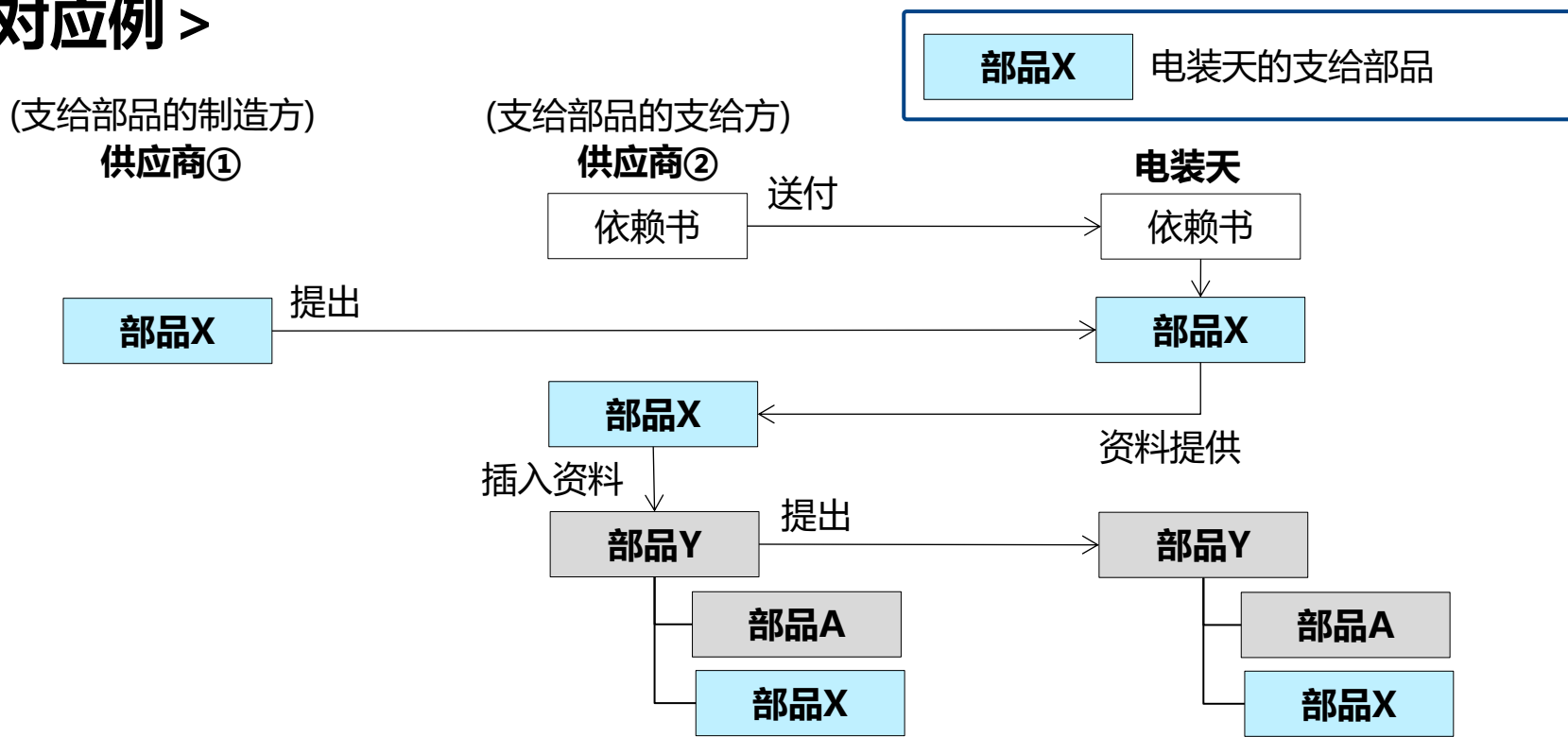
多品図対象品番リスト Part number list for multi-part drawing	
1	123000-12300700
2	123000-22300700
3	123000-32300700

代表图号

(9)制品中包含电装天支給部品的情況

- ・ 支給部品の資料信息由我司進行提供。請填寫「支給部品的信息提供
依賴書」，向我司進行依賴。由於提供該資料信息需要花費一定時間，
所以請盡量提前進行依賴。
- ・ 從我司收到資料信息後，請加之在貴司資料中進行報告。

< 對應例 >





< 依赖资料提供窗口 >

【日本】

株式会社电装天 HMI)技術企画部 ハード技術企画室 技術企画課

E-Mail: ten-jama_soc@mlst.denso-ten.com

【日本以外】

请发送给我司海外据点各位担当者。

< E-Mail的文件名 >

【依赖】 支給部品資料の提供

< 支給部品の資料提供依頼書 >

支給部品のデータ提供依頼書							
依頼社名		仕入先 コード		必要な データ形式	IMDS	送信先 企業ID	
納入部品番号 (テン品番)	納入部品名称 (テン品名)		支給部品番号 (テン品番)		支給部品名称 (テン品名)		

(10)提出方法（不定形材料*1）

- ・不定形材料，请在セミコンポーネント提交

< 构成情报画面 >

制作セミコンポーネント，在那个下边安置素材数据

セミコンポーネント検索 構成情報 サプライヤー情報 送信先情報 分析 入力依頼

フィルター GADSL

▼ L. RESIN FLUX CORED S.

- ▼ 100.0% SOLDER
 - 96.5% Tin
 - 3.25% *****
 - 0.25% *****

詳細

▼ 共通情報

Type セミコンポーネント (所有データシート)

ID/バージョン 947022941 / 0.01

ノードID 947022941

ノード数 5

サプライヤー DENSO TEN Limited

部品名称 L. RESIN FLUX CORED S. *

材料コード 060101-99990700

生産準備初期段階の「事前申告」データシート ☐

▼ 日付

作成日 2020/0

確認/リリース日 なし

▼ 数量と質量

単位あたりの質量 1.0 kg/m (単位長あたり) *

部品名称
请填写TEN的品名

※用对本公司产品的使用之后的
最终状态请报告。
请除去使用以后挥发的成分。

材料コード
请填写TEN的品番
※15位(需要有“-”存在)

不定形材*1:指向副材料的事情。

被用于产品上，说用常温、干燥状态残留的素材的事情。
(焊接，亚麻，润滑油，溶剂)

< 接收方情报画面 >

セミコンポーネント検索 構成情報 サプライヤー情報 送信先情報 分析 入力依頼

名称 L. RESIN FLUX CORED S. | ID/バージョン 947022941 / 0.01 | ノードID 947022941 | ステータス 編集モード

送信 全送信 社内送信 公開

DENSO Corporation [333] 編集モード (2020/08/03)

詳細

送信情報

企業 DENSO Corporation [333]
組織 -
送信先ステータス 編集モード

サプライヤーコード

名称 L. RESIN FLUX CORED S.

材料コード 060101-99990700

旧式スペアパーツ ☐

送受信/確認日 なし

図面情報

設計変更番号

部品名称
请填写TEN的品名

材料コード
请填写TEN的品番
※15位(需要有“-”存在)

5.

IMDS的警告内容相关

(1)报错·警告的确认

(2)修正对应相关

5. IMDSの警告内容相关

(1)报错・警告の确认

- ・由IMDSの错误确认栏识别出来的报错・警告，请尽快确认内容并进行报告。

< IMDSの报错・警告确认方法 >

The screenshot displays the IMDS (Material Data System) interface. At the top, the title bar reads 'MATERIAL DATA SYSTEM'. Below it, the 'データシート/モジュール検索' (Data Sheet/Module Search) tab is active. A blue box highlights the '错误确认' (Error Confirmation) button in the top navigation bar, with a label '错误确认按键' (Error Confirmation Button) pointing to it.

Below the navigation bar, a table lists the results of the search. The table has columns for 'No.', 'タイプ' (Type), 'タブ' (Tab), '優先' (Priority), and 'メッセージ' (Message). The 'タイプ' column contains icons for warnings (yellow triangle) and errors (red circle with 'X'). The 'タブ' column lists '構成情報' (Composition Information). The 'メッセージ' column contains the specific error or warning text.

Two blue boxes highlight the '警告' (Warning) and '报错' (Error) icons in the 'タイプ' column. The '警告' box points to the yellow triangle icon, and the '报错' box points to the red circle with 'X' icon.

No.	タイプ	タブ	優先	メッセージ
2	警告	構成情報		材料に"Aluminium (metal)"が50%より多く含まれていますが、選択されている材料分類が適切ではありません。適切な材料分類:2.1, 2.1.1, 2.1.2, 7.3, 8.1, 8.2
3	报错	構成情報		全ての化学物質のアプリケーションを指定して下さい。
4	警告	構成情報		含有率の範囲値の差が許容値を越えてはなりません。
5	报错	構成情報		材料分類が指定されていません。
6	警告	構成情報		材料に"Aluminium (metal)"が50%より多く含まれていますが、選択されている材料分類が適切ではありません。適切な材料分類:2.1, 2.1.1, 2.1.2, 7.3, 8.1, 8.2
7	警告	構成情報		参照データシート/モジュールは最新バージョンではありません。

< 警告内容の確認方法 >

警告内容の含义，请从下述URL中进行确认。

<https://public.mdsystem.com/zh/web/imds-public-pages/faq>



可以看到FAQ(常见问题)的画面。

请确认下方内容。



可以看到『IMDS错误和规范』的字样。

点击后会显示详细的内容。



点击后会显示详细的内容，请进行参考。

- IMDS错误提示以及解决方案
- 如何改正IMDS中的错误

(2)修正对应相关

- IMDS与JAMA表不同，接收到的资料，在我司无法进行资料内容的修改与订正
- 所以关于报错内容，请全部进行修改后提交。
- 关于警告内容，请遵循次页以及之后的内容，进行确认以及修正。
作为我司来说，并不是强制要求贵司完全修正警告内容后才可以提交，但是，如果有顾客要求等需要修正资料内容的情况的话，还是需要贵司协助配合。（即使我司先行确认OK的情况也是如此。）

①部品之下，部品和材料在同一阶层中出现的情况

· 关于该警告，请在消除警告内容后进行报告。

< IMDS的CHECK：关于不同种类的物品配置在同一阶层的情况 >

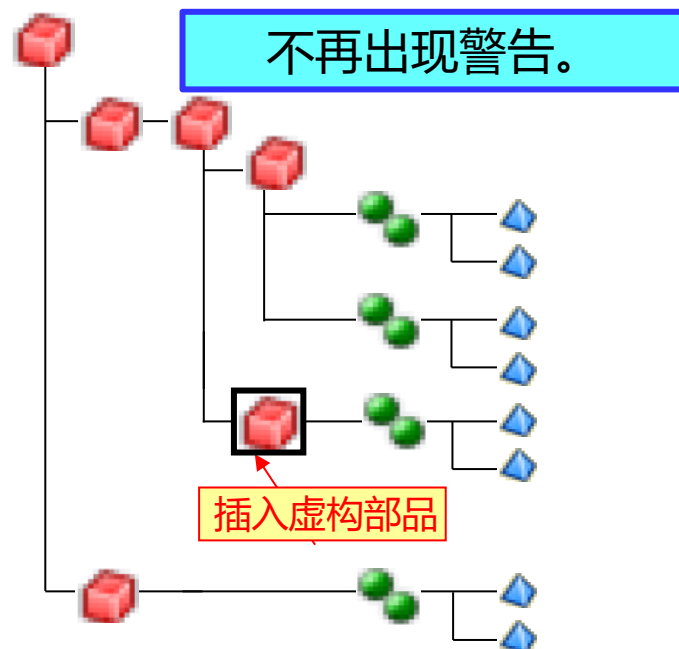
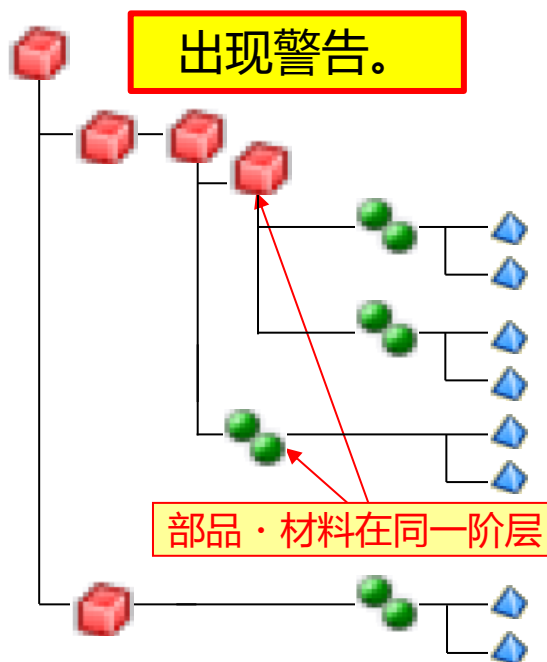
IMDS用户手册 3.3.14 ERROR CHECK

- 在IMDS中，当同一母部品的下面同时拥有部品与材料，并在同一阶层内出现的时候，会产生警告。

< 对应方法 >

- 该场合，请插入一个虚构部品（※），来消除警告内容。

※虚构部品的名称，可以随意使用，但是，推荐使用材料名称作为虚构部品名称。

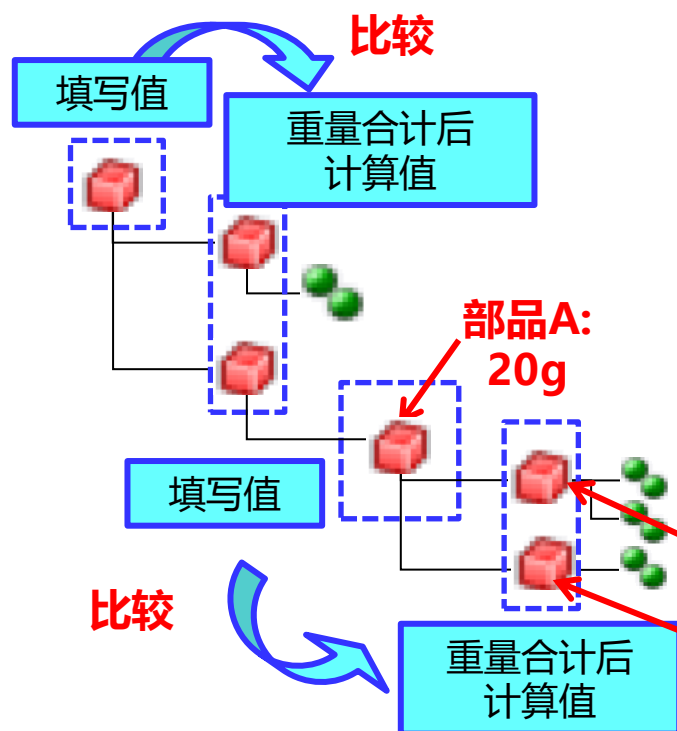


②部品的重量最大偏差超过IMDS的基准值的时候

· 关于该警告，请在消除警告内容后进行报告。

< IMDS的CHECK: 以部品重量为基准的最大偏差 > IMDS用户手册 3.3.14 ERROR CHECK

- 在IMDS中，会以母部品的重量值为基准，确认子部品的重量最大偏差值量。
※ERROR CHECK会在部品构成的全部阶段进行内容的确认。
- 请修改到不再出现误差为止。就算再容许范围内，也请将合计重量修改为一致数值。
(原因：我司向客户进行制品报告的时候，质量值必须严格控制在公差数值内。)



ERROR CHECK 的基准值

母部品的质量 (M)	最大偏差 [%]
$M < 1g$	100
$1g \leq M < 100g$	10
$100g \leq M < 1Kg$	5
$1kg \leq M < 10kg$	2
$10kg \leq M < 100kg$	1
$10kg \leq M$	1

出现警告。

左边的情况，在母部品的重量为：20g的前提下，子部品的重量合计后为23g，产生了15%的偏差，导致出现警告。

③化合物的含有率的范围超过IMDS基准值的情况

・关于该警告，请在消除警告内容后进行报告。

< IMDS的规则：以部品重量为基础的最大偏差 > IMDS推荐手册 4.5.4 含有率的范围值
IMDS用户指导手册

3.3.14 ERROR CHECK

・化合物的含有率的公差（最小值－最大值）按照下述进行规定。请贵司在报告的时候，控制在该公差范围内。

※JIS等官方规格定义的材料的情况，即使超过公差范围，也可以承认有效性。

含有率的范围值

化合物含有率 最大 = Y% 最小 = X%	允许公差范围 $M = Y\% - X\%$
$0 \leq X \leq 7.5$	$M \leq 3$
$7.5 < X \leq 20$	$M \leq 5$
$20 < X \leq 100$	$M \leq 10$

④树脂·橡胶材料的成分为单一化合物100%构成的情况

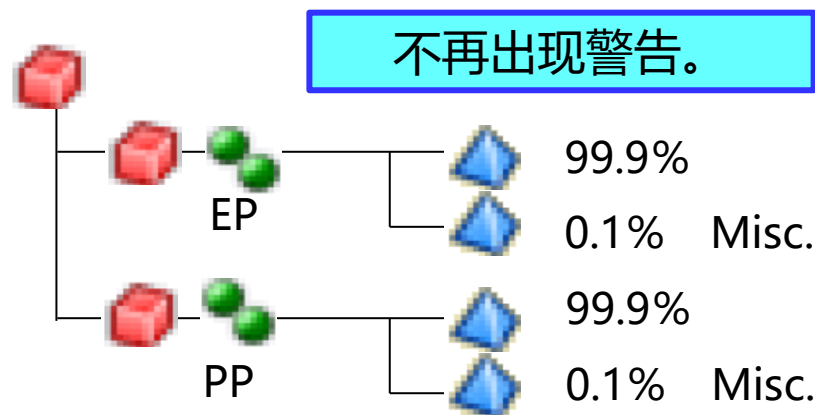
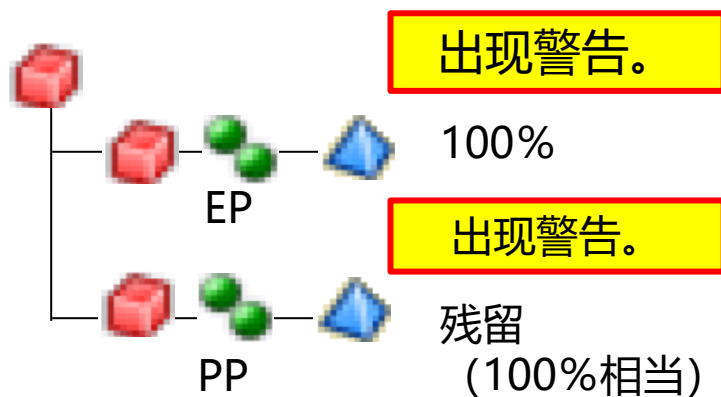
· 关于该警告，请在消除警告内容后进行报告。

< IMDS的CHECK: 材料分类为 5.x 或者6.x 的时候，由单一化合物物质100%构成的材料
且资料清单为新做成的情况 > IMDS用户指导手册 3.3.14 ERROR

CHECK

- 关于VDA材料分类5.x、6.x的材料，当1物质的含有率为100%的情况，会产生警告。
(为了防止树脂·橡胶物品的添加物记载疏漏，请确认其他添加物并填写在资料中)

< 对应例 >



⑤铬物质、非动态中的水

・ 关于该警告，基本上如果确实含有水成分的话，不作为确认对象。

< IMDS的CHECK：材料中液体以及气体的化学物质含量超过1%，且材料分类不是9.x的情况，或者，特定的化学物质含量超过1%的情况 >

IMDS用户操作手册 3.3.14 EORRO CHECK

・ 铬物质中如果确实含有水物质的话，即使发生警告，也无需修正，可以直接进行报告。

< 参考 >

・ IMDS官方材料中，铬物质（黑）已经登陆，并且该登录信息中含有水物质。所以，像下述这样，含有水物质的材料被直接判断为正确的情况也存在。

■ IMDS公开材料 IMDS ID(材料): 73281512/2

材料検索 構成情報 サプライヤー情報 送信先情報 分析 入力情報

フィルター GADSL 規制情報

▼ JAMAHCRCF-TR-ZNPL B

- 残部 10.5% Chromium(III)oxide
- 4.5 - 6.5% Chromium(III)-hydroxide
- 9.0 - 11.0% Water
- 50.0 - 56.6% Dichromium tris(hydrogen phosphate)
- 18.0 - 22.0% Zinc-hydroxide
- Misc., not to declare

詳細

▼ 共通情報

タイプ 材料 (公開データシート)

ID/バージョン 73281512 / 3

ノードID 768189201

ノード数 7

サプライヤー IMDS-Committee / ILI Metals

名称 JAMAHCRCF-TR-ZNPL B

⑥关于VDA的材料分类

< IMDS的CHECK: 当材料内的特定化学物质含有率比制定的含有率多的情况 >

IMDS用户指导手册 3.3.14 ERROR CHECK

- IMDS的ERROR CHECK中如果出现警告的情况, 请确认信息栏中显示的候补内容, 重新选择最适合的材料分类。

※材料分为为正确 (适宜的选项没有显示出来的情况) 的情况下, 也有可能出现警告。

查错按键

确认信息并修改适宜的内容。

警告信息

No.	メッセージ	ノード/拡張子	メッセージ
1	構成情報	Copy_EP	全てのGADSL記載物質を申告したことを確認してください。
2	構成情報	Copy_EP	材料分類5.4.3の材料には、化学物質グループ"Chk: Named *poly* w/o polymers"の化学物質が15%より多く含まれてはなりません。
3	構成情報	Copy_EP	材料の化学物質が15%より多く含まれていますが、選択されている材料分類5.4.3が適切ではありません。適切な材料分類: 4.2, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2

候补内容会显示出来。
该例的情况, 材料分类: 4.2, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2

6.

物质调查资料作成上的注意点

※请活用在品质向上活动中

- (1)GADSL记载物质请务必报告
- (2)需要报告最终制品中的含有状态
- (3)必须与最新的设计变更、材料变更一致
- (4)物质调查资料需要通过供应商链进行传达
- (5)每个均质材料均需要进行材料报告
- (6)需要报告有无材质表示
- (7)正确报告部品重量
- (8)玻璃成分的填写方法
- (9)材料情报的名称栏中需要填写材料名称

6. 物质调查资料作成上的注意点

(1) GADSL记载物质请务必报告

< 规则 > 如果GADSL记载物质超过阈值的情况，则必须填写
Wildcard的使用限度（最大使用量为重量的10%未知）
IMDS Recommendation 001 规则3.2.1.D、 规则4.5.2.C

< 特别重点注意事项 >

①资料作成（新规作成、更新）时

(a)GADSL记载物质

- 当超过规定阈值的时候，请务必向我司进行报告。
- 请务必不要利用Wildcard（高机密物质（Misc., not to declare等））

来规避信息的公开

(b) Wildcard（非公开）

- 当使用Wildcard的时候，请不要超过10%的使用量。
 - ※IMDS中，高机密物质与机密物质（Confidential Substance）的合计值不能超过10%。
 - ※当Wildcard选项作为残留物补充选项的时候，请注意未申告化学物质的合计不要超过10%。

②需要情报更新的时候

修改GADSL时

- 当使用Wildcard进行报告的物质被GADSL记载的情况，请迅速向我司进行联络。

< 最新的GADSL确认方法 >

GADSL的官网中进行了公示。

<http://www.gadsl.org/>



下载『GADSL Reference List』
文件并进行保存。

打开保存的『20XX_Reference_v_X.xlsx』文件。

打开GADSL的EXCEL文件的『Reference List』，可以确认GADSL分类。

[2] 点击『5』。

[1] 选择Sheet 『Reference List』。

[3] 可以看到物质清单。

确认GADSL分类信息。

(2)需要报告最终制品中的含有状态

重要的

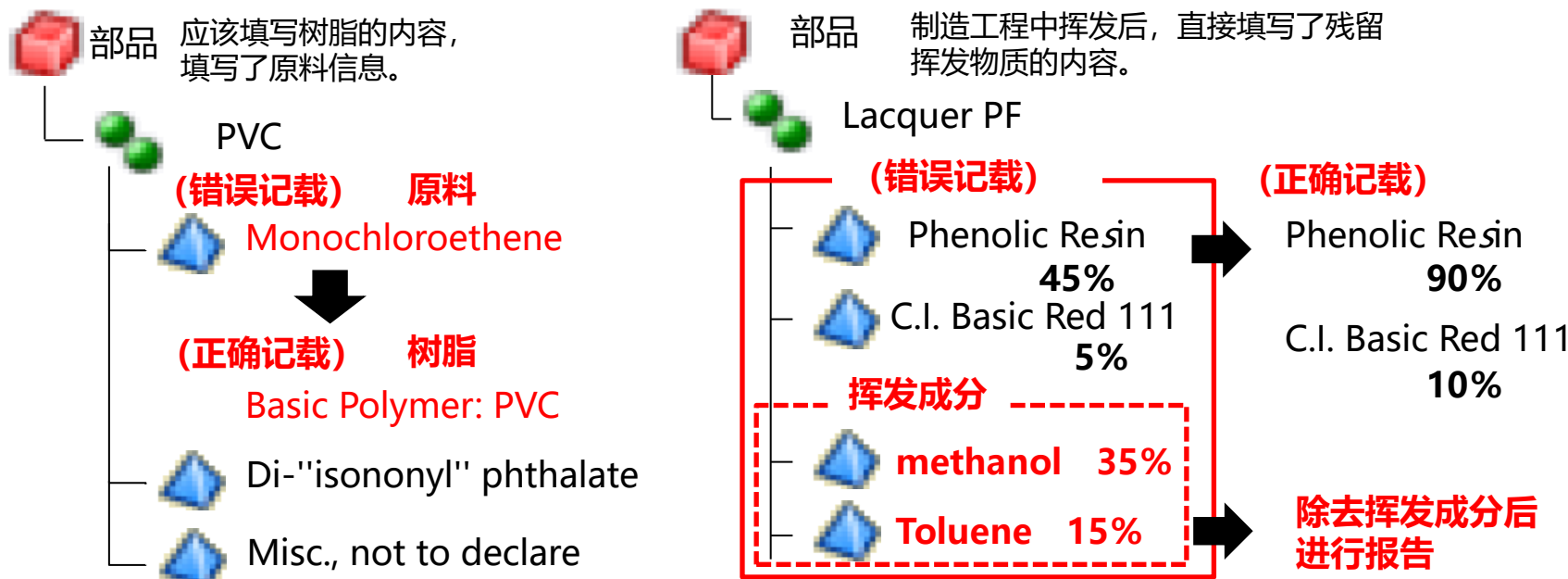
< 规则 > 填写最终制品中含有的物质信息

IMDS Recommendation 001 规则4.4.1.B、规则4.4.1.C

< 特别重点注意事项 >

- ①当物质为树脂时，请不要报告原料内容，请以树脂进行报告。
- ②涂料以及粘着剂的场合，由于制造工程中会发生挥发，所以需要减掉挥发物质（化学工序），报告凝固后的状态的信息。

< 事例 >



参考：樹脂用的选择项目（疑似物质）

- ・ 对树脂进行报告时，需要使用最终制品状态进行报告，不要使用原料内容进行报告。
- ・ 关于树脂相关情报，我司列出下述的选择项（疑似物质）供大家参考。请活用在向材料厂商确认情况等工作上。

材料名称（日本語）	材料記号 (JISK6899-1)	IMDSでの選択肢 (化合物名称)
アクリロニトリル-ブタジエン-アクリル酸エステルプラスチック	ABAK	Basic Polymer: ABAK
アクリロニトリル-ブタジエン-スチレンプラスチック	ABS	Basic polymer: ABS
アクリロニトリル-塩素化ポリエチレン-スチレン	ACS	Basic Polymer: ACS
アクリロニトリル-（エチレン-プロピレン-ジエン）-スチレンプラスチック	AEPDS	Basic Polymer: AEPDS
アクリロニトリル-メタクリル酸メチルプラスチック	AMMA	Basic Polymer: AMMA
アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステルプラスチック	ASA	Basic Polymer: ASA
酢酸セルロース	CA	Basic Polymer: CA
酢酸酪酸セルロース	CAB	Basic Polymer: CAB
酢酸プロピオン酸セルロース	CAP	Basic polymer: CAP
セルロースホルムアルデヒド	CEF	Basic Polymer: CEF
クレゾールホルムアルデヒド樹脂	CF	Basic Polymer: CF
カルボキシメチルセルロース	CMC	Basic Polymer: CMC
硝酸セルロース	CN	Basic Polymer: CN
シクロオレフィンコポリマー	COC	Basic polymer: COC
プロピオン酸セルロース	CP	Basic polymer: CP
三酢酸セルロース	CTA	Basic Polymer: CTA
エチレン-アクリル酸プラスチック	EAA	Basic Polymer: EAA
エチレン-アクリル酸ブチルプラスチック	EBAK	Basic Polymer : EBAK
エチルセルロース	EC	Basic Polymer: EC
エチレン-アクリル酸エチルプラスチック	EEAK	Basic Polymer: EEAK
エチレン-メタクリル酸プラスチック	EMA	Basic Polymer: EMA
エポキシド，エポキシ樹脂又はエポキシプラスチック	EP	Basic Polymer: EP
エチレン-プロピレンプラスチック	E/P	Basic Polymer: E/P
エチレン-テトラフルオロエチレンプラスチック	ETFE	Basic Polymer: ETFE
エチレン-酢酸ビニルプラスチック	EVAC	Basic Polymer: EVAC
エチレン-ビニルアルコールプラスチック	EVOH	Basic Polymer: EVOH
ペルフルオロ（エチレン-プロピレン）プラスチック	FEP	Basic Polymer: FEP
フuran-ホルムアルデヒド樹脂	FF	Basic Polymer: FF
液晶ポリマー	LCP	Basic Polymer: LCP
メタクリル酸メチル-アクリロニトリル-ブタジエン-スチレンプラスチック	MABS	Basic Polymer: MMABS

材料名称（日本語）	材料記号 (JISK6899-1)	IMDSでの選択肢 (化合物名称)
メタクリル酸メチル-ブタジエン-スチレンプラスチック	MBS	Basic Polymer: MBS
メチルセルロース	MC	Basic Polymer: MC
メラミン-ホルムアルデヒド樹脂	MF	Basic Polymer: MF
メラミン-フェノール樹脂	MP	Basic Polymer: MP
α-メチルスチレン-アクリロニトリルプラスチック	MSAN	Basic Polymer: MSAN
ポリアミド	PA	Basic Polymer: PA
ポリアリールエーテルケトン	PAEK	Basic Polymer: PAEK
ポリアミドイミド	PAI	Basic Polymer: PAI
ポリアクリル酸エステル	PAK	Basic Polymer: PAK
ポリアクリロニトリル	PAN	Basic Polymer: PAN
ポリアラート	PAR	Basic Polymer: PAR
ポリアリールアミド	PARA	Basic Polymer: PARA
ポリブテン	PB	Basic Polymer: PB
ポリアクリル酸ブチル	PBAK	Basic Polymer: PBAK
1，2-ポリブタジエン	PBD	Basic Polymer: PBD
ポリブチレンテレフタレート	PBT	Basic Polymer: PBT
ポリカーボネート	PC	Basic Polymer: PC
ポリシクロヘキシレンジメチレン=テレフタレート	PCT	Basic Polymer: PCT
ポリクロロトリフルオロエチレン	PCTFE	Basic Polymer: PCTFE
ポリジアルファレート	PDAP	Basic Polymer: PDAP
ポリジシクロペンタジエン	PDCPD	Basic Duomer: PDCPD
ポリエチレン	PE	Basic Polymer: PE
ポリエチレン，塩素化	PE-C	Basic polymer: PE-C
ポリエチレン，高密度	PE-HD	Basic Polymer: PE-HD
ポリエチレン，低密度	PE-LD	Basic polymer: PE- LD
ポリエチレン，線状低密度	PE-LLD	Basic polymer: PE-LLD
ポリエチレン，中密度	PE-MD	Basic polymer: PE-MD
ポリエチレン，超高分子量	PE-UHMW	Basic polymer: PE-UHMW
ポリエステルカーボネート	PEC	Basic Polymer: PEC
ポリエーテルエーテルケトン	PEEK	Basic Polymer: PEEK

材料名称（日本語）	材料記号 (JISK6899-1)	IMDSでの選択肢 (化合物名称)
ポリエーテルエステル	PEEST	Basic Polymer: PEEST
ポリエーテルイミド	PEI	Basic Polymer: PEI
ポリエーテルケトン	PEK	Basic Polymer: PEK
ポリエチレンナフタレート	PEN	Basic polymer: PEN
ポリエチレンオキシド	PEOX	Basic Polymer: PEOX
ポリエステルウレタン	PESTUR	Basic Polymer: PESTUR
ポリエーテルスルホン	PESU	Basic Polymer: PES
ポリエチレンテレフタレート	PET	Basic Polymer: PET
ポリエーテルウレタン	PEUR	Basic Polymer: PEUR
フェノール-ホルムアルデヒド樹脂	PF	Phenol-formaldehyde Resin
ペルフルオロアルコキシアルカン樹脂	PFA	Basic Polymer: PFA
ポリイミド	PI	Polyimide
ポリイソブチレン	PIB	Basic Polymer: PIB
ポリイソシアヌレート	PIR	Basic Polymer: PIR
ポリケトン	PK	Basic Polymer: PK
ポリメタクリルイミド	PMI	Basic Polymer: PMI
ポリメタクリル酸メチル	PMMA	Basic Polymer: PMMA
ポリ（N-メチルメタクリルイミド）	PMMI	Basic Polymer: PMMI
ポリ（4-メチルペンタ-1-エン）	PMP	Basic Polymer: PMP
ポリ（ α -メチルスチレン）	PMS	Basic Polymer: PMS
ポリオキシメチレン，ポリアセタール，ポリホルムアルデヒド	POM	Basic Polymer: POM
ポリプロピレン	PP	Basic Polymer: PP
ポリプロピレン，発泡性	PP-E	Basic Polymer: PP-E
ポリフェニレンエーテル	PPE	Basic Polymer: PPE
ポリプロピレンオキシド	PPOX	Basic Polymer: PPOX
ポリフェニレンスルフィド	PPS	Basic Polymer: PPS
ポリフェニレンスルホン	PPSU	Basic Polymer: PPSU
ポリスチレン	PS	Basic Polymer: PS
ポリスチレン，発泡性	PS-E	Basic Polymer: PS-E
ポリスチレン，耐衝撃性	PS-HI	PS-HI (HIPS)

材料名称（日本語）	材料記号 (JISK6899-1)	IMDSでの選択肢 (化合物名称)
ポリスルホン	PSU	Basic Polymer: PSU
ポリテトラフルオロエチレン	PTFE	Basic polymer: PTFE
ポリトリメチレンテレフタレート	PTT	Basic Polymer: PTT
ポリウレタン	PUR	Basic Polymer: PUR
ポリ酢酸ビニル	PVAC	Basic Polymer: PVAC
ポリビニルアルコール	PVAL	basic Polymer: PVAL
ポリビニルブチラール	PVB	Basic Polymer: PVB
ポリ塩化ビニル	PVC	Basic Polymer: PVC
ポリ塩化ビニル，塩素化	PVC-C	Basic Polymer: PVC-C
ポリ塩化ビニリデン	PVDC	Basic Polymer: PVDC
ポリふっ化ビニリデン	PVDF	Basic Polymer: PVDF
ポリふっ化ビニル	PVF	Basic Polymer: PVF
ポリビニルホルマール	PVFM	Basic Polymer: PVFM
ポリ-N-ビニルカルバゾール	PVK	Basic Polymer: PVK
ポリ-N-ビニルピロリドン	PVP	Basic Polymer: PVP
スチレン-アクリロニトリルプラスチック	SAN	Basic Polymer: SAN
スチレン-ブタジエンプラスチック	SB	Styrene-butadiene rubber
シリコンプラスチック	SI	Silicone resin
スチレン-無水マレイン酸プラスチック	SMAH	Basic Polymer: SMAH
スチレン- α -メチルスチレンプラスチック	SMS	Basic Polymer: SMS
ユリア-ホルムアルデヒド樹脂	UF	Basic Polymer: UF
不飽和ポリエステル	UP	Basic Duomer: unsaturated polyester resin
塩化ビニル-エチレンプラスチック	VCE	Basic Polymer: VCE
塩化ビニル-エチレン-アクリル酸メチルプラスチック	VCEMAK	Basic Polymer: VCEMAK
塩化ビニル-エチレン-酢酸ビニルプラスチック	VCEVAC	Basic Polymer: VCEVAC
塩化ビニル-アクリル酸メチルプラスチック	VCMAC	Basic Polymer: VCMAC
塩化ビニル-メタクリル酸メチルプラスチック	VCMMA	Basic Polymer: VCMMA
塩化ビニル-アクリル酸オクチルプラスチック	VCOAK	Basic Polymer: VCOAK
塩化ビニル-酢酸ビニルプラスチック	VCVAC	Basic Polymer: VCVAC
塩化ビニル-塩化ビニリデンプラスチック	VCVDC	Basic Polymer: VCVDC

- ・ 上述为树脂用化合物的部分例子。除上述以外，JIS中未定义的树脂、Polymer Alloy（复数的树脂混合后的树脂）等，登陆了复数的选择项目，请进行活用。

参考：环氧树脂的填写方法

- < 规则 >
- 用于粘着剂或者蜂蜡的树脂必须要填写凝固后的状态信息。
 - 如果含有在凝固状态中必须申告的化合物的情况，必须要对该物质进行申告（报告）（IMDS推荐手册001a）。
- < 推荐 >
- 硬化后的环氧树脂，除去必须申告的化学物质以外，推荐使用Basic Duromer: Epoxy resin（CAS No.无）等疑似物质来进行报告。（IMDS推荐手册012）。

< 填写上的注意点 >

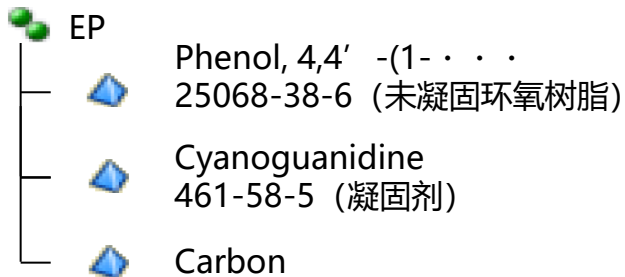
- 未凝固树脂与凝固剂两种材料都有的时候，两者一起使用疑似物质来进行填写*。
- 凝固剂无法共存的情况，请将未凝固树脂作为疑似物质进行填写*。

*注）从供应商处收到的资料信息中如果填写了凝固的环氧树脂的话，该场合未凝固树脂以及凝固剂中有可能均含有未反应物。必须向供应商确认是否残存以及含有率。当存在未反应物的情况，可以不进行修正。

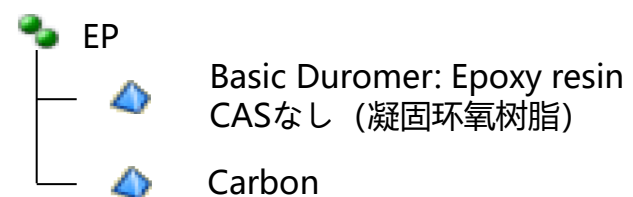
- 未凝固树脂为溴化物的情况。请使用疑似物质Basic duromer: Brominated epoxy resin 进行填写（请参考次页：选定最合适的疑似物质）。

< 事例 >

< 误 > （报告了未凝固状态的物质）



< 正 > （完全凝固后的正确例）



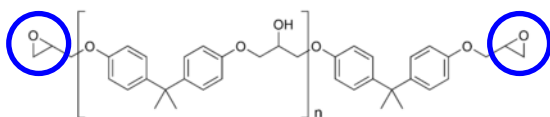
下图为环氧树脂凝固前后的对照表。未凝固环氧树脂也有可能单独发生个体凝固，下图所示，环氧基（○部）中一分子中只有两个附着材料，从几何学来说，

由于无法形成网眼状构造，所以无法单独发生个体凝固*。

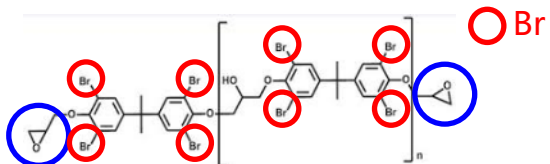
*注）像这样的未凝固树脂个体也会由于分子量变大变成固体，但是这种情况存在热可塑性（直链状集合体），并非凝固（网眼状构造个体化）。

未凝固树脂

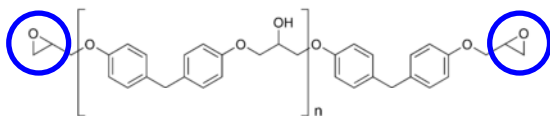
CAS No. 25068-38-6



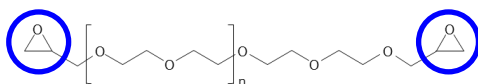
CAS No. 40039-93-8



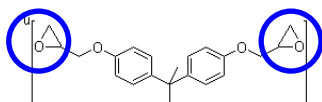
CAS No. 58421-55-9



CAS No. 25928-94-3



CAS No. 25085-99-8



凝固树脂

CAS No. 无

Basic duromer: Epoxy resin

CAS No. 无

Basic duromer: **Brominated** epoxy resin

CAS No. 无

Basic duromer: Epoxy resin

CAS No. 无

Basic duromer: Epoxy resin

CAS No. 无

Basic duromer: Epoxy resin

(3)必须与最新的设计变更、材料变更一致

< 规则 > 当追加新材料，或者部品中不再使用报告中的材料时，相对应的资料信息也需要修改后再次发送。

IMDS Recommendation 001 规则3.2.1.B

< 特别重点注意事项 >

- 设计变更，材料变更·追加等，物质调查清单有变更的时候，需要再次提交。

变更例：涂层变更 1层 → 2层

变更例：铅含有品 → 切替为无铅品

(4)物质调查资料需要通过供应商链进行传达

< 规则 > 材料信息需要通过供应商链 ($Tier^n \rightarrow Tier^{n-1} \rightarrow \dots$ 汽车厂商)进行传达。

材料信息资料，只能由制造材料的企业进行作成。

IMDS Recommendation 001 规则3.1.A、规则4.4.1.E

< 特别重点注意事项 >

- 材料厂商需要填写材料的成分情报。

- 部品厂商，需要使用从材料厂商收到的材料信息来作成部品资料信息。

(5)每个均质材料均需要进行材料报告

< 规则 > 每个均质材料均需要填写

IMDS Recommendation 001 规则4.4.1.D、 001a 1.1IMDS关于材料分类的选择

< 特别重点注意事项 >

- 「均质」指机械性的由复数的材料组成并无法分离的材料组成情况。
请确认材料是否作为均值材料进行了填写。

镀硅钢板

< 事例① >

(错误记载)



部品



镀锌钢板



Carbon



Manganese



Iron



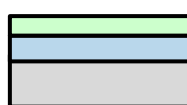
Zinc (metal)



Misc., not to declare



Polydimethyl-siloxane



硅胶 (涂层)

镀锌

SPHC (母材金属)



(正确记载)



部品



SPHC (母材金属)



Carbon



Manganese



Iron



镀锌



Zinc (metal)



Misc., not to declare



硅胶涂层

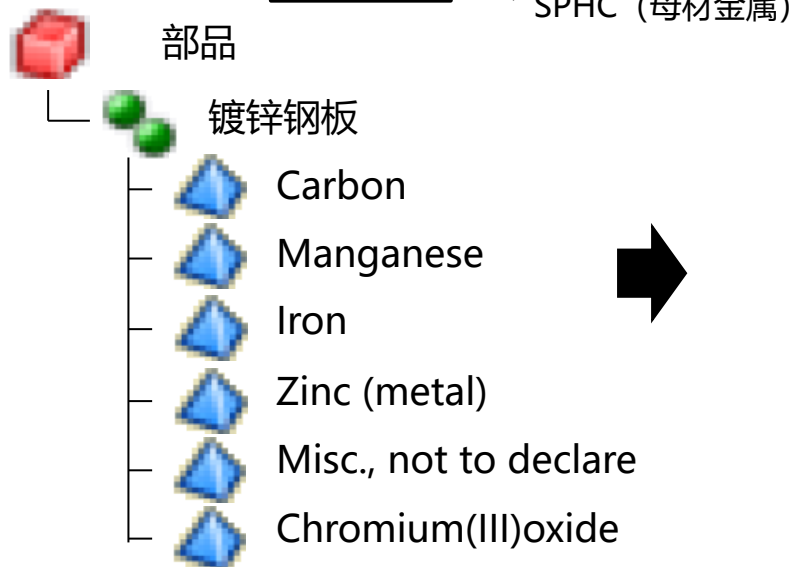


Polydimethyl-siloxane

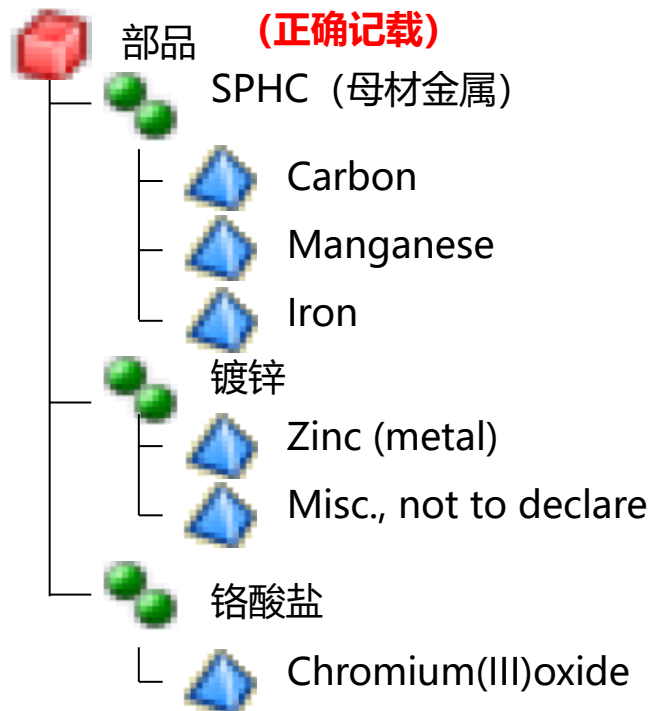
如果是铬酸盐处理钢板

< 事例② >

(错误记载)



(正确记载)



(6)需要报告有无材质表示

< 规则 > 当符合下述条件的情况，需要回答有无材质表示。

基准值： 「VDA分类5.1.x或者为5.4.x」 且 「超过100g」
「VDA分类5.2或者为5.3」 且 「超过200g」

IMDS 用户指导手册 3.3.9 树脂・橡胶制部品的材质表示

< 特别重点注意事项 >

- ・ 「N (NO)」说明即使材质表示为必须项，但是仍旧没有进行表示，通常意味着并没有对此情况进行过设想。请不要使用「N (NO)」进行回答。
※重量为基准值以下所以没有材质表示的时候，请选择「N/A (无该选项)」进行回答。
- ・ ASSY购入品的构成部品也是同样，如果VDA分类，重量条件都满足的情况，同样需要回答材质表示的内容。

(7)正确报告部品重量



< 规则 > 需要报告正确的重量（部品重量）。

IMDS Recommendation 001 规则4.2.2.A

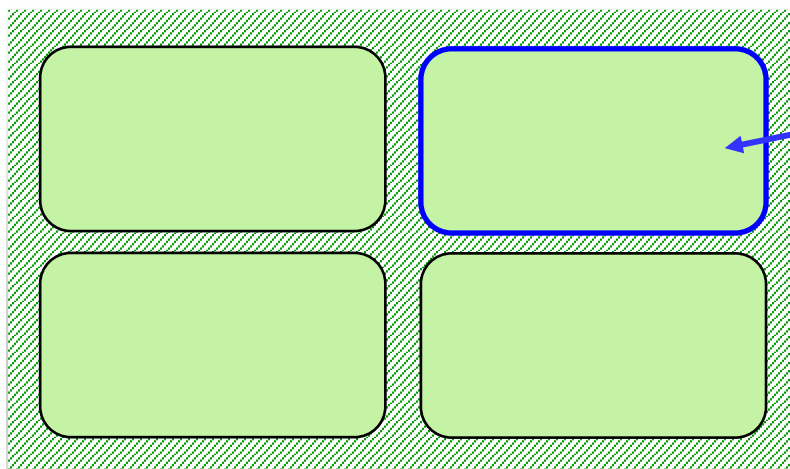
< 特别重点注意事项 >

- 请参考确认图纸上的重量信息，对重量进行实际测量等，务必报告正确的重量信息。
- 电路板的输入方法

请输入用于敝公司产品（包括多片装盒）的单片质量

例)取一张时 →输入不包括废弃电路板部分的重量

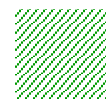
取4张时 →输入不含废弃电路板的单片重量



输入省去废弃底板部分的
敝公司产品使用的每枚的
质量



电路板



废弃电路板 (耳)

(8)玻璃成分的填写方法

< 推荐 > · 新做成的玻璃，陶瓷，搪瓷等商品的资料信息，务必需要填写单一的（疑似）化学

的单纯的材料信息。当无法变更资料信息的情况，会直接使用既存的材料清单表。

· 当包含必须申告的化学物质的情况，请遵循IMDS推荐手册001的一般规则，追加并进行指定。

IMDS Recommendation 001a 2.6 玻璃，陶瓷以及搪瓷制品的资料作成

< 填写上的注意点 >

· 新资料作成时，请只使用UVCB（※）作成。

※UVCB：组成物质为不明或者不定的。复杂的反应合成物或者生物材料

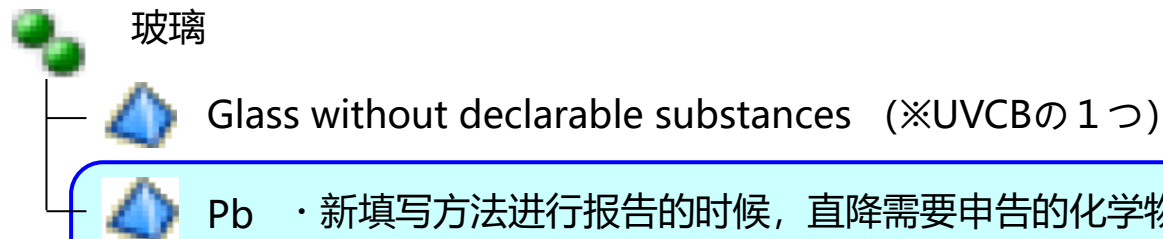
(Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials)

< 事例 >

< 旧填写方法 >



< 新填写方法 >



我司推荐使用该新填写方法进行作成。

· 新填写方法进行报告的时候，直降需要申告的化学物质Pb单独区分出来进行记载即可。

· 另外，作为原料的PbO请不要记载。

(9)材料情报的名称栏中需要填写材料名称

< 规则 > 材料情报清单的名称的词条，需要填写材料名称。

IMDS Recommendation 001 规则4.4.2 材料情报清单中记载的情报

< 特别重点注意事项 >

- 如果存在正式的材料规格（JIS、ISO等）规定的名称，请务必使用该正式名称进行登录。
上述内容如果不存在的情况，请按照下述要求填写。
- 可以特定出材料种别的具体的名称
(例：Carbon steel, Stainless steel etc.)
- JAMA表格内登陆的材料记号、材料号码
(例：FE, AL, SINTERFE, ABS, PC, etc.)

材料検索 構成情報 サプライヤー情報 送信先情報 分析 入力依頼

フィルター GADSL 規制情報の表示

▼ SUS304

- 0.04% Carbon
- 1.1% Manganese
- 8.2% Nickel
- 17.86% Chromium
- 72.8% Iron

詳細

☑ 共通情報

タイプ 材料 (モ)

ID/バージョン 877995618 /

ノードID 877995618

ノード数 6

名称 SUS304

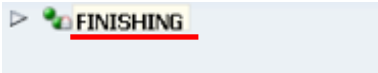
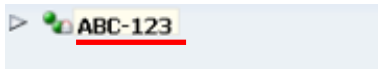
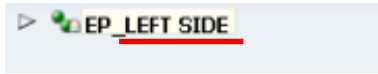
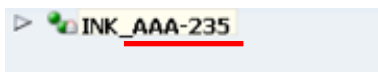
商品名

社内材料コード -

呈産準備初期段階の「事前 いいえ
申告」データシート

填写材料名称

如果输入以下内容，则为NG，因此请正确输入材料名称。
(我们可能会收到客户的拒绝)

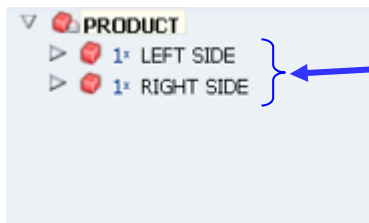
NG案例	主要案例	NG输入示例 (赤线部分)
输入了材料名称以外的名称	已输入组件名称	
		
	产品名称已输入	
已输入材料名称，但也已输入其他名称	已输入组件名称	
		
	产品名称已输入	

作为一种当您想指示材料的使用地点（成分信息）时的方法，下面将描述相应的示例。如果你想区分一个组件中的相同材料，你可以这样做。

<对应例子>



输入了材料名称以外的名称 →NG



创建组件并显示组件信息。



将材料数据更正为正确的材料名称，并将其放在组件下。

7.

使用电装产品编号的 IMDS 报告(补充信息)

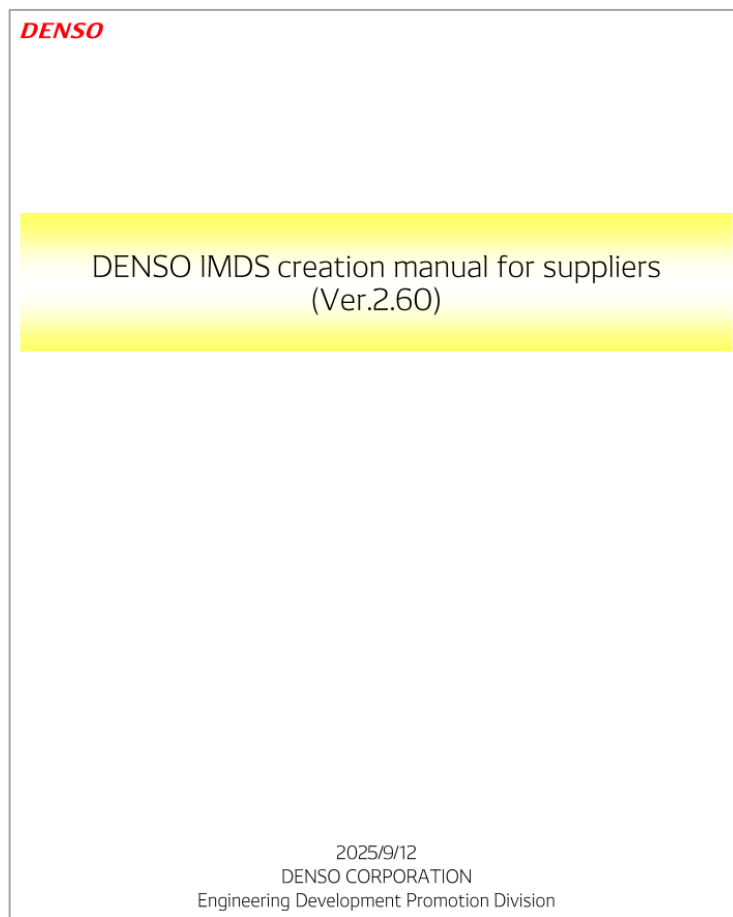
7. 使用电装产品编号的 IMDS 报告(补充信息)



对于使用电装零件号交付的零件，请应用下面的电装版本手册

<URL>

<https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/society/supply-chain/green-procurement/>



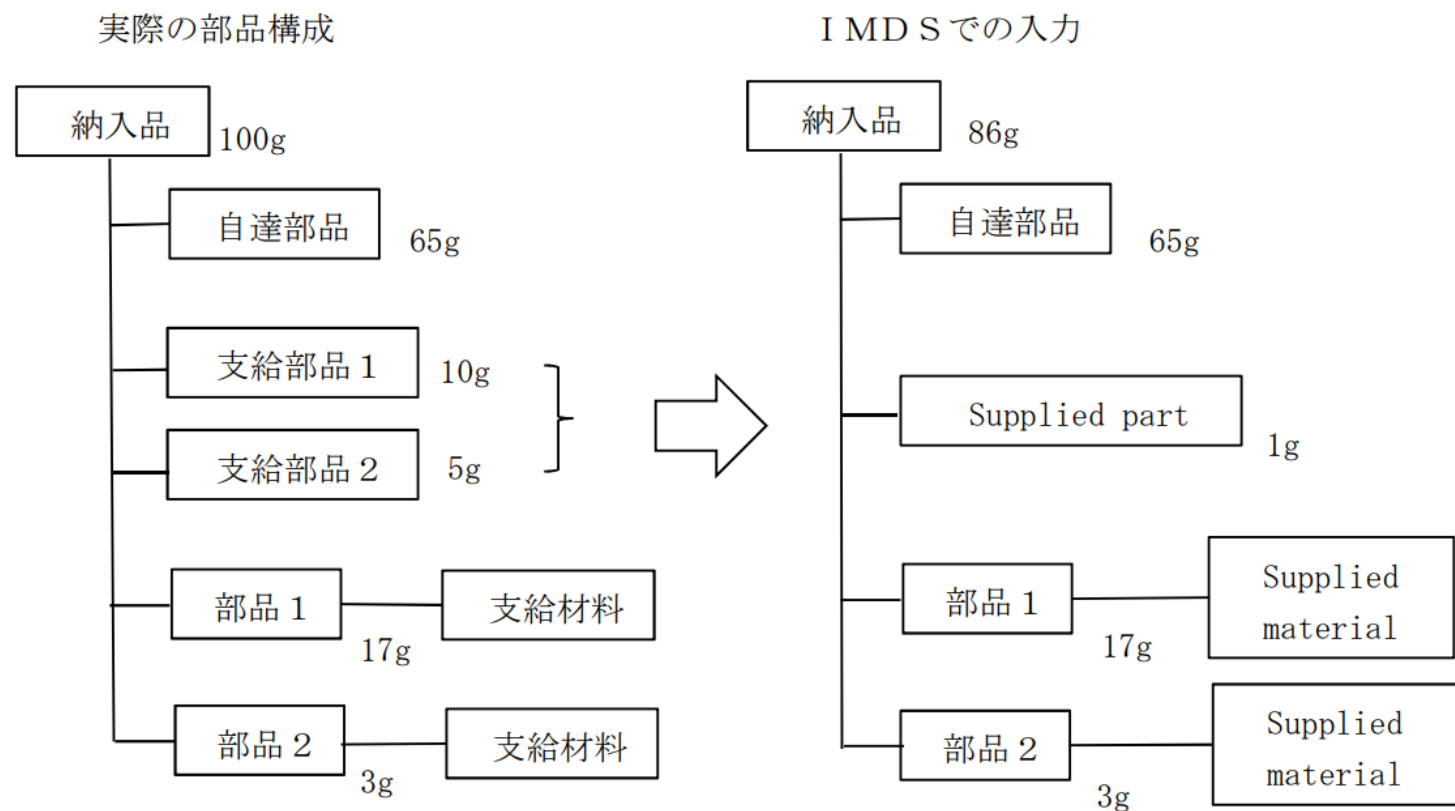
如果支給部品、支給材料存在，请执行以下(请参阅下一页的示例)

※摘自电装的「供应商质量保证手册 (SQAM)」

項目	支給部品（仕入先の工程で質量が変化しない場合）	支給材料、および支給部品（仕入先の工程で質量が変化する場合）
支給品に使用するデータ	Supplied part (IMDS ID:940087927/1)	Supplied material (IMDS ID:940039686/1)
質量	支給部品は1gとしてあります。 (支給部品の質量は1gとして納入品の質量を計算してください)	支給材料を使用している実際の質量を入力してください。 最終的な材料、部品の質量を入力してください。
個数	“1” としてください。	支給材料を使用する部品の個数を入力してください。
その他	複数の支給部品がある場合は、1つの支給部品データを使用してください。 (複数の支給部品データを入力する必要はありません)	複数の支給材料がある場合はそれぞれを入力してください。その場合はダミー部品を入れてください。ダミー部品の番号は任意とします。

※摘自电装的「供应商质量保证手册 (SQAM)」

(例)



8.

咨询窗口

8. 咨询窗口



IMDS的操作方法・登录・填写方法・资料做成方法・教育・手册・规则・设定方法
等内容相关的询问，请联系下述窗口。

・ IMDS服务中心

【日本】

e-mail: jpimds-helpdesk@dx.com

电话: 03-4530-9270

【日本以外】

请参考下述主页中内容。

<https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/imds-service-centers>

关于电装天的固有的要求事项相关资讯，请咨询下述窗口。

【日本】

株式会社电装天 品質・技術推進本部 技術管理部 設計管理室 標準管理課

e-mail: ten-eco-product@mlst.denso-ten.com

【日本以外】

我司海外据点担当者

改版履历

生效日		修订内容
1.00	制定 2019年9月4日	新规制定
1.01	修订 2019年11月25日	・追加发送方企业(组织ID)一览 (13页) ・追加日本以外的联络信息(25、50页)
1.02	修订 2020年6月26日	・我司部署名变更 (31、58页) ・页数追加 基本项目的填写例 (13~16页) 再利用情报 (28页) 提出对象品番 (29页) 提出方法 (不定性材料) (32页) 材料情报的名称栏中需要填写材料名称 (56页)
1.03	修订 2021年10月1日	・不定形材的介绍方法变更(32、33页) 把介绍方法从コンポーネント改为セミコンポーネント ・本公司海外提供据点名的变更, 删掉(17页)
1.04	修订 2022年2月16日	・追加如何查看回收信息是否有回复(29页) ・材料数据名称栏新增缺陷案例和响应案例 (59、60页)

改版履历

生效日		修订内容
1.10	修订 2023年3月28日	•项目1(2) 修改适用范围说明 (增加了电装天零件号和电装零件号的内容) •项目4(5) 添加禁用的应用程序代码 添加可根据目的使用的应用程序代码页面 •项目4(8) 添加多部分图需提交的部分编号内容 •项目 6 (5) 添加均质材料示例 (添加普通示例)
1.20	修订 2023年6月2日	•项目4(7) 反映 IMDS 14.0 版中回收信息的变化 •覆盖、项目4(9)、项目7 部门名称变更 (变更后：技術管理部設計管理室標準管理課)
1.30	修订 2024年3月1日	•项目7 添加了有关使用电装产品编号的 IMDS 报告的附加信息

改版履历

生效日		修订内容
1.40	修订 2025年11月3日	•项目1(2) 内容更新 (零件号说明、增加案例等) •项目4(1) 增加ID/Version相关注意事项 •项目6(7) 增加基板质量输入方法 •表紙、项目4(9)、项目9 变更部门名称、邮箱地址

DENSO TEN